

Technologie CMOS a FPGA

Jan Kořenek

Brno University of Technology, Faculty of Information Technology
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole
korenek@fit.vutbr.cz

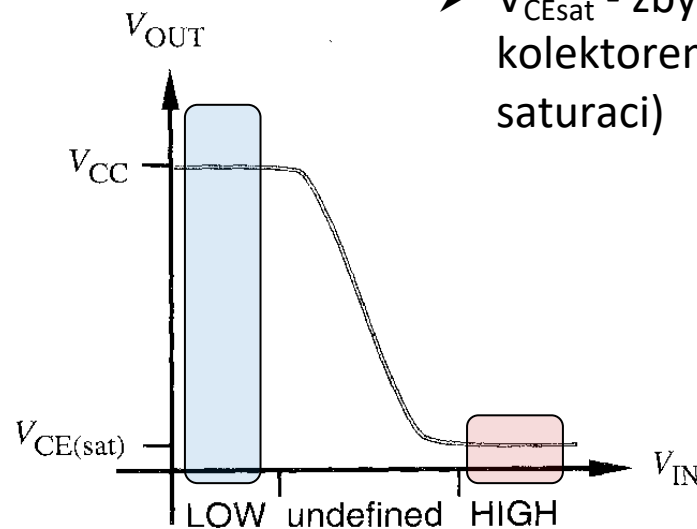
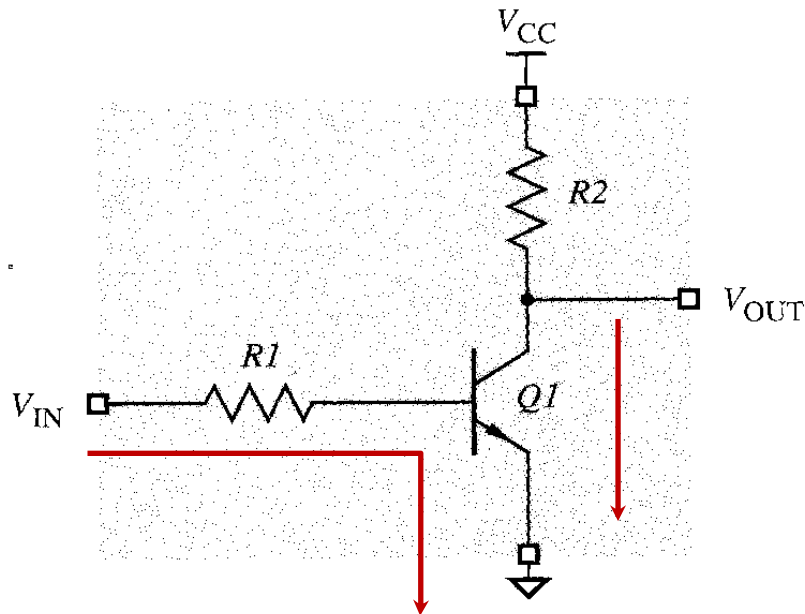


- Seznámit se se základy technologie CMOS
 - Princip fungování a zapojení Invertoru a logických členů NAND a NOR v technologii CMOS na úrovni tranzistorů.
 - Ukázat si funkci dalších obvodů: třístavové budiče, přenosový člen a buffer.
 - Napěťové úrovně a převodní charakteristika logických členů.
- Definovat co způsobuje příkon v technologii CMOS
 - Pochopit co ovlivňuje dynamický příkon a jakým způsobem se dá redukovat.
 - Vliv napájecího napětí na příkon a zpoždění obvodu (DVFS).
- Seznámit se se způsobem programování obvodů PLA a PAL a znát vlastnosti těchto obvodů
- Pochopit vlastnosti technologií ASIC a FPGA z pohledu výkonnosti a flexibility
- Seznámit se se strukturou technologie FPGA
 - Způsoby práce s funkčním generátorem: RAM, posuvný registr nebo LUT.
 - Možné realizace paměti v rámci FPGA

- *Technologie CMOS*
- Příkon v technologii CMOS
- Programovatelné struktury (PLD)
- Technologie FPGA

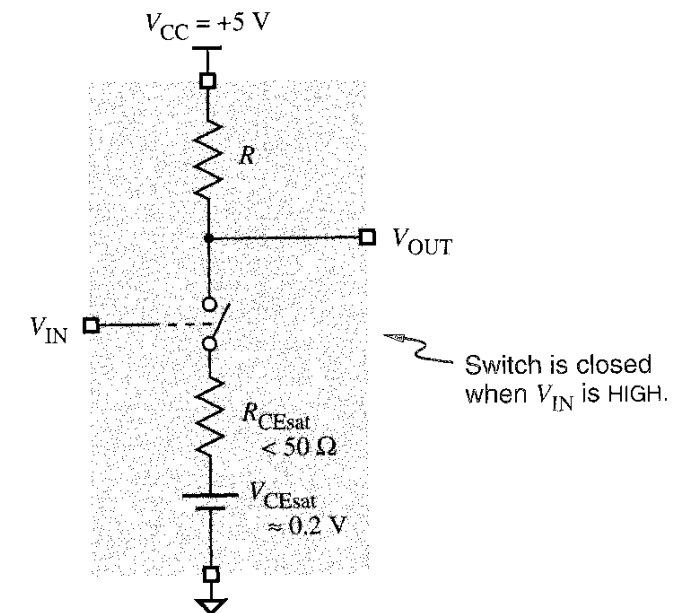
• Schéma invertoru pomocí bipolárního tranzistoru:

- V bázi musí být rezistor $R1$ omezující proud
- Přídavný rezistor $R2$ na kolektoru (pull-up)



• Náhradní schéma tranzistoru jako spínače

- R - přídavný rezistor (pull-up)
- R_{CEsat} - odpor tranzistoru mezi kolektorem a emitorem při jeho plném otevření (v saturaci)
- V_{CEsat} - zbytkové napětí tranzistoru mezi kolektorem a emitorem při jeho plném otevření (v saturaci)



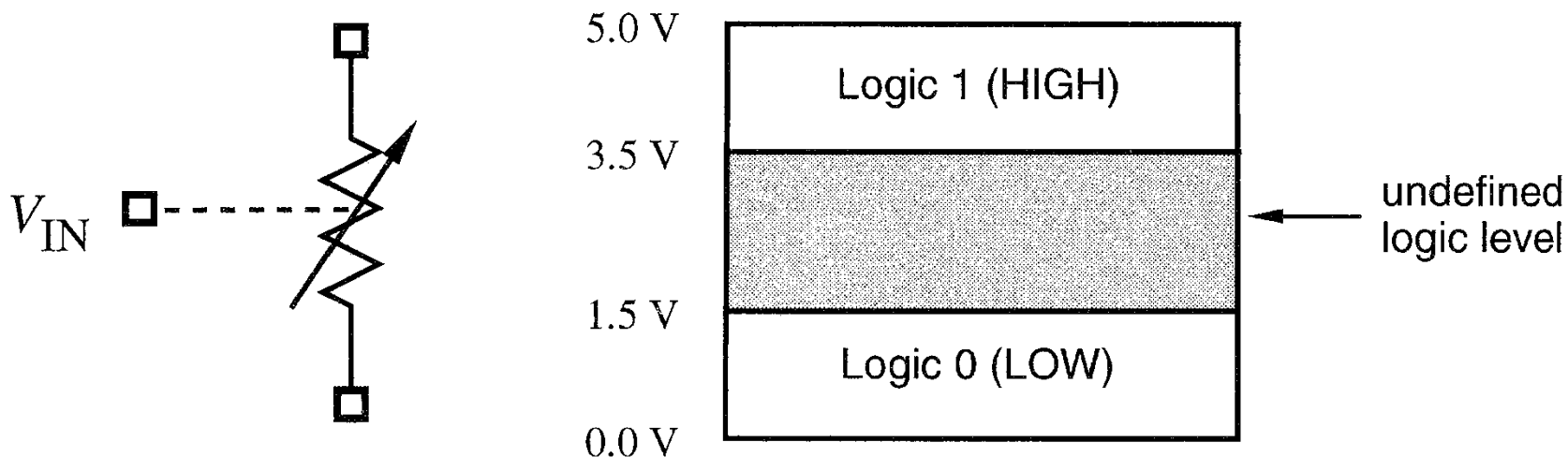
1963: První CPU z IO
(použito pro řízení Apollo)

Technologie	Příkon	Rychlost
Resistor-Transistor Logic (RTL)	***	*
Diode-Transistor Logic (DTL)	***	*
Transistor-Transistor Logic (TTL)	**	**
Emitter-Coupled Logic (ECL)	***	***
Positive Metal Oxide Semiconductor (pMOS)	**	*
Negative Metal Oxide Semiconductor (nMOS)	**	**
Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)	*	**
Gallium Arsenide (GaAs)	***	***

První technologie
CMOS vyvinuta již
v roce 1970

Díky svým
vlastnostem dnes
velmi používaná
technologie

- Název vychází ze zkratk
 - **MOSFET** zkratka vychází z **Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor**, zkráceně se také označuje pouze MOS
 - **CMOS** je zkráceným názvem **Complementary MOS**
- Základem je MOSFET tranzistor, který pracuje jako „rezistor řízený napětím”
- Logické úrovně typického CMOS obvodu
 - HIGH (logická 1) odpovídá úrovni napětí V_{IN} v rozsahu 3,5V až 5V
 - LOW (logická 0) odpovídá úrovni napětí V_{IN} v rozsahu 0V až 1,5V



- „Gate” - řídicí elektroda

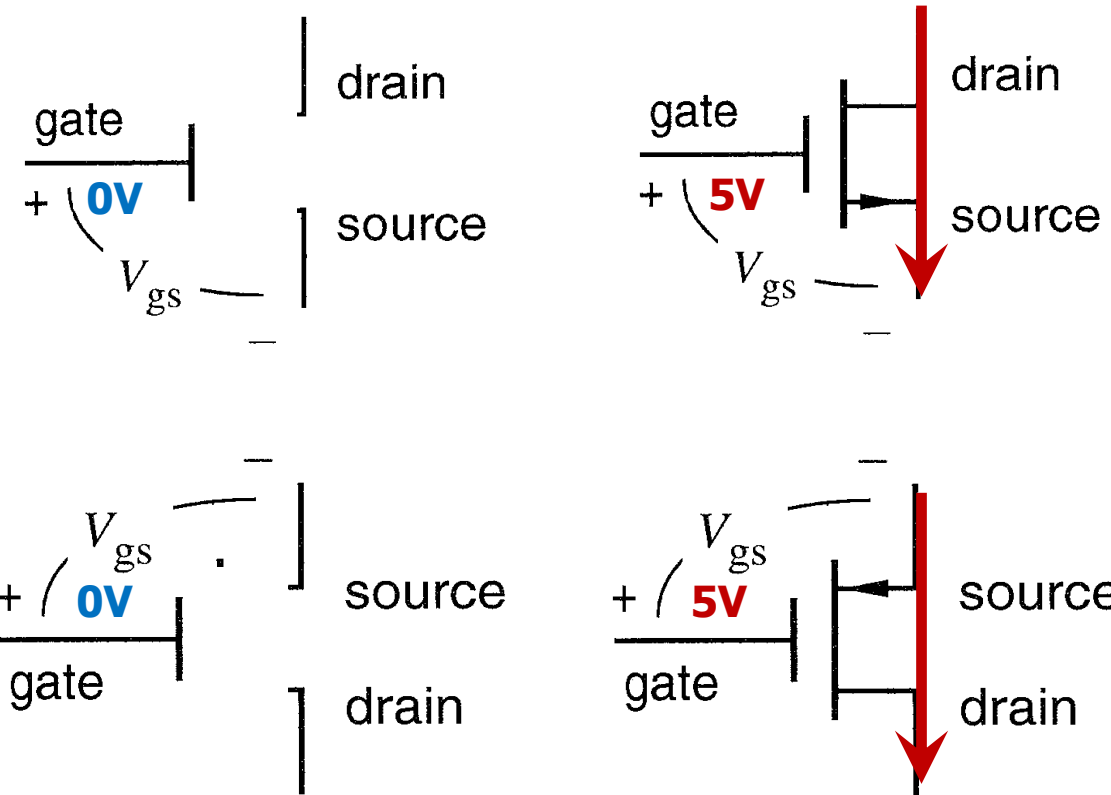
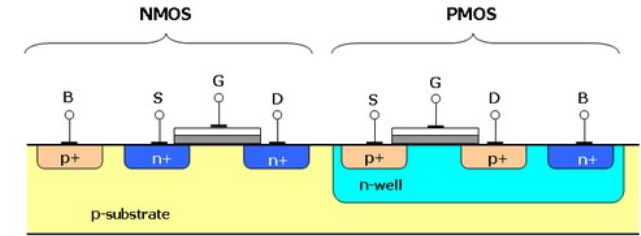
- Napětí mezi elektrodami gate a source ovládá činnost tranzistoru (sepnutý nebo rozepnutý stav)

- **Tranzistor MOS s kanálem n**

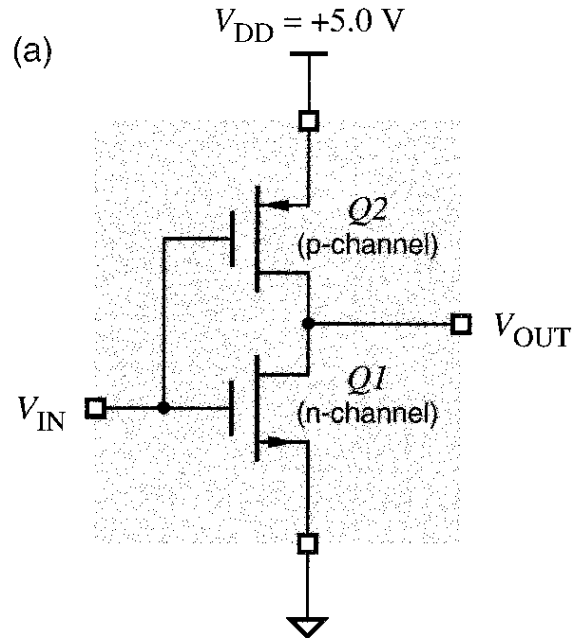
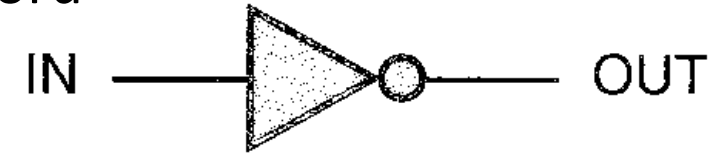
- Elektroda drain je připojena na vyšší napětí než source
- Pro $V_{gs}=0$ má přechodový odpor mezi drain a source (R_{ds}) desítky $M\Omega$
- Pro V_{gs} vyšší než prahová úroveň má R_{ds} jednotky Ω

- **Tranzistor MOS s kanálem p**

- Elektroda source je na vyšším napětí než drain
- Pro $V_{gs}=0V$ má přechodový odpor mezi drain a source (R_{ds}) desítky $M\Omega$
- Pro V_{gs} vyšší než prahová úroveň má R_{ds} jednotky Ω

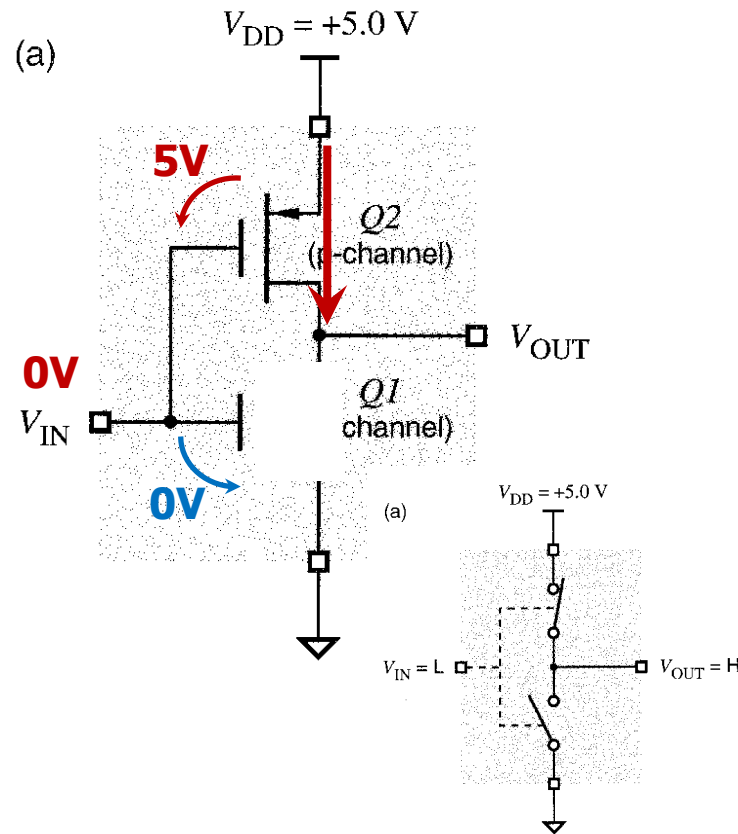


- CMOS Invertor je sestaven ze dvou komplementárních tranzistorů MOSFET, z nichž vždy jeden je sepnut a druhý rozepnut

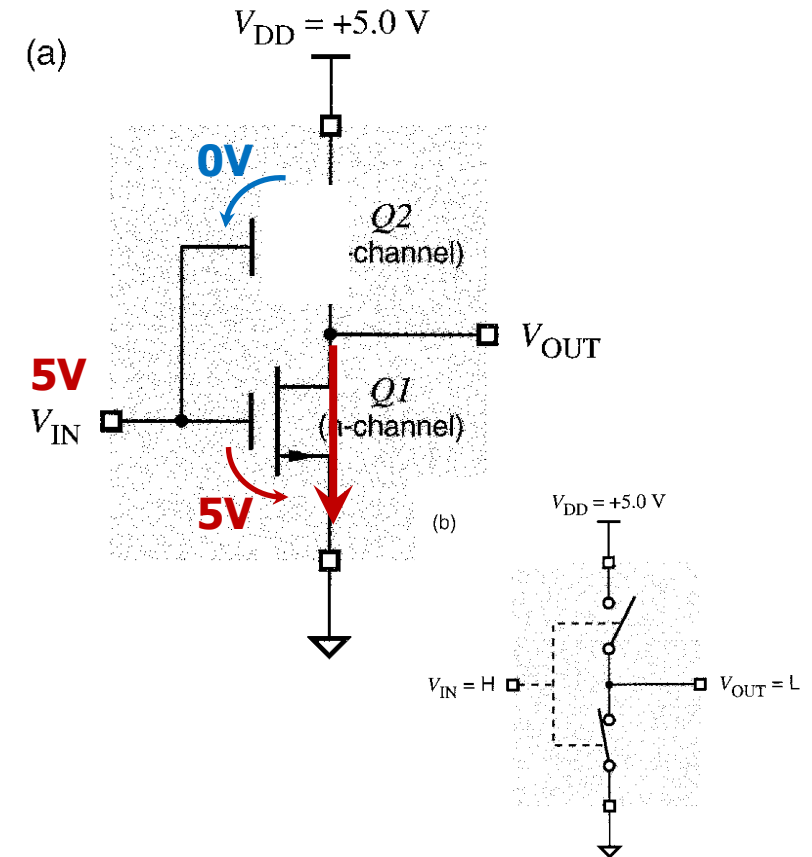


V_{IN}	$Q1$	$Q2$	V_{OUT}
0.0 (L)	off	on	5.0 (H)
5.0 (H)	on	off	0.0 (L)

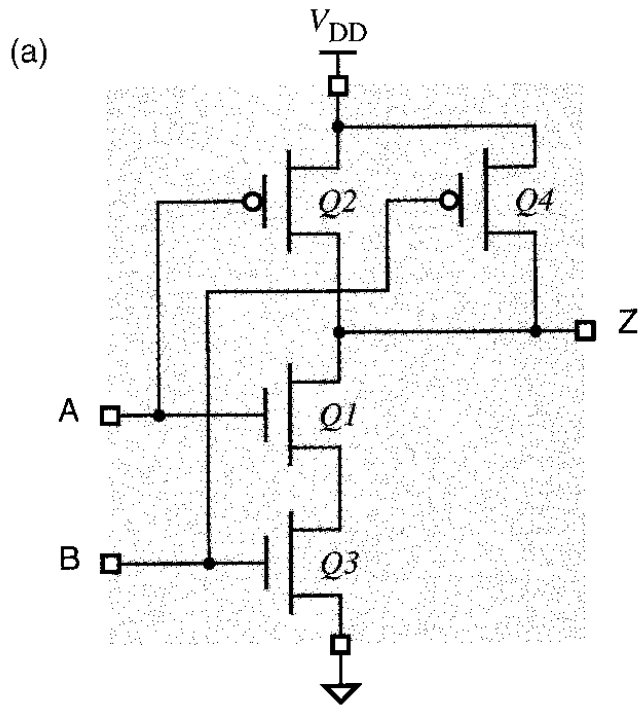
$V_{IN} = \text{Low (0} \rightarrow 1)$



$V_{IN} = \text{Low (1} \rightarrow 0)$



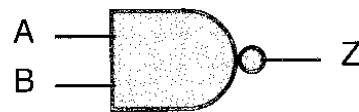
- Realizace dvou-vstupého hradla NAND pomocí čtyř komplementárních tranzistorů MOSFET



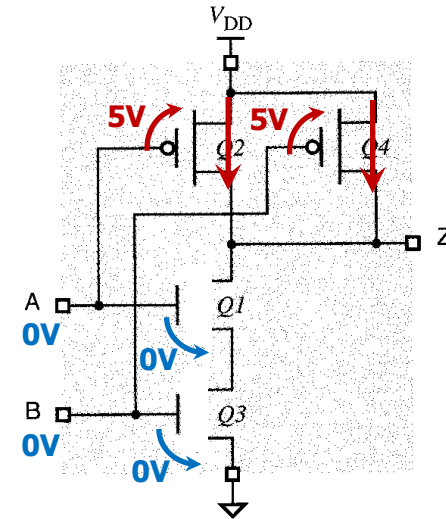
(b)

A	B	Q1	Q2	Q3	Q4	Z
L	L	off	on	off	on	H
L	H	off	on	on	off	H
H	L	on	off	off	on	H
H	H	on	off	on	off	L

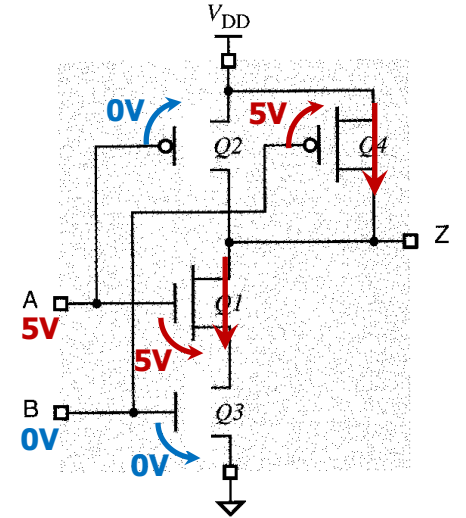
(c)



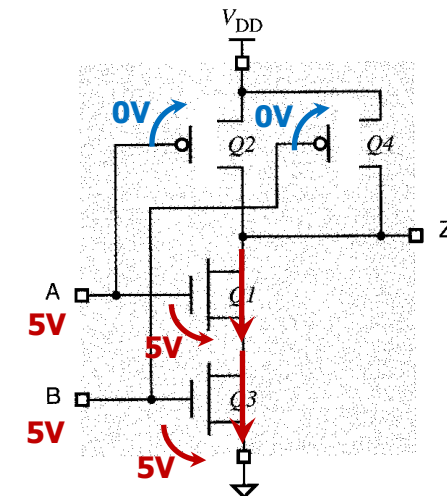
A = 0 (Low), B = 0 (Low)



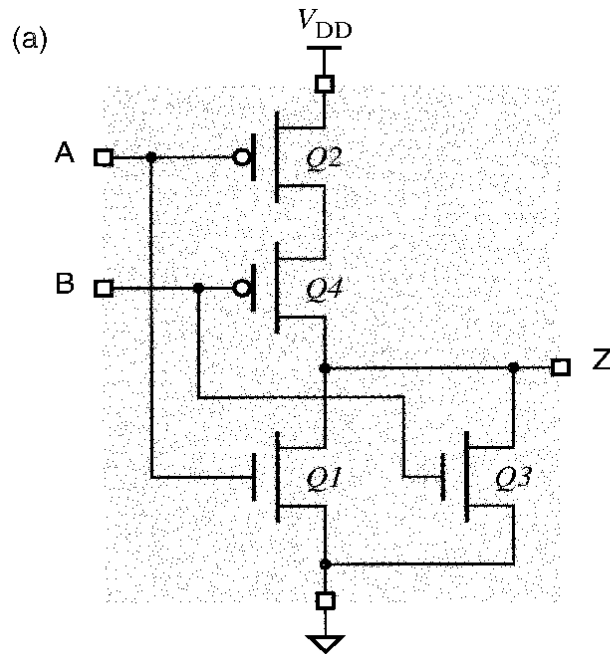
A = 1 (High), B = 0 (Low)



A = 1 (High), B = 1 (High)



- Realizace dvou-vstupého hradla NOR pomocí čtyř komplementárních tranzistorů MOSFET



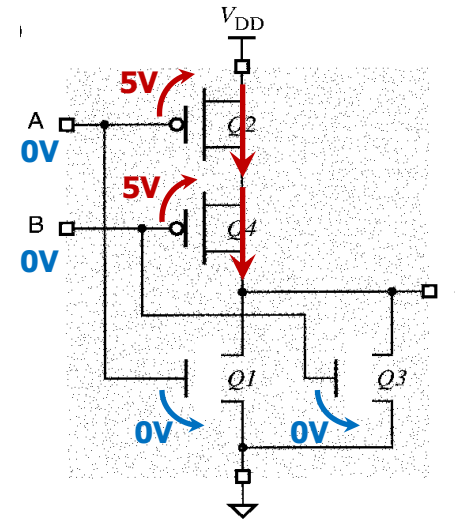
(b)

A	B	Q1	Q2	Q3	Q4	Z
L	L	off	on	off	on	H
L	H	off	on	on	off	L
H	L	on	off	off	on	L
H	H	on	off	on	off	L

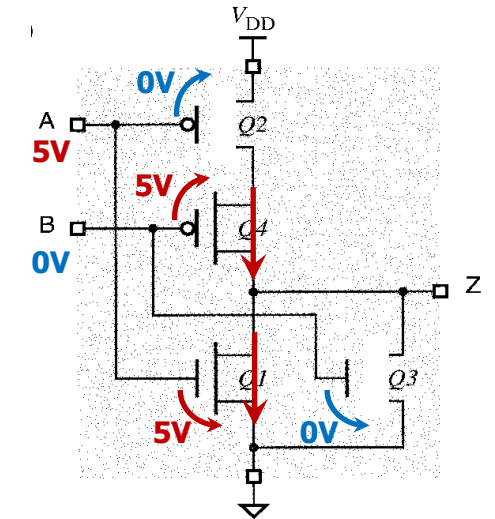


- Hradlo CMOS NOR je pomalejší než hradlo CMOS NAND, neboť při stejných rozměrech mají tranzistory s p-kanálem větší přechodový odpor v otevřeném stavu
- Pokud jsou tedy tranzistory s p-kanálem (Q2 a Q4) řazeny v sérii, budou mít pomalejší odezvu díky pomalejšímu nabíjení parazitních kapacit

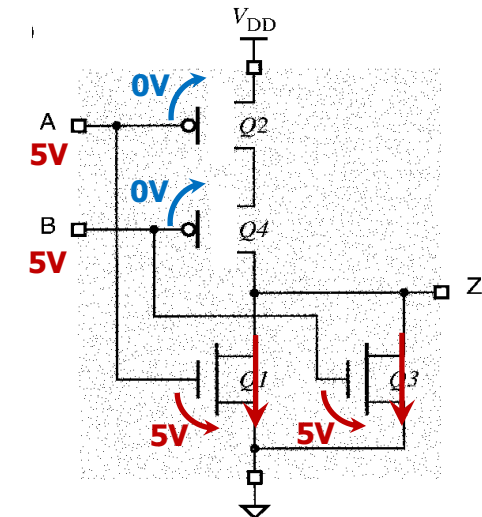
A = 0 (Low), B = 0 (Low)



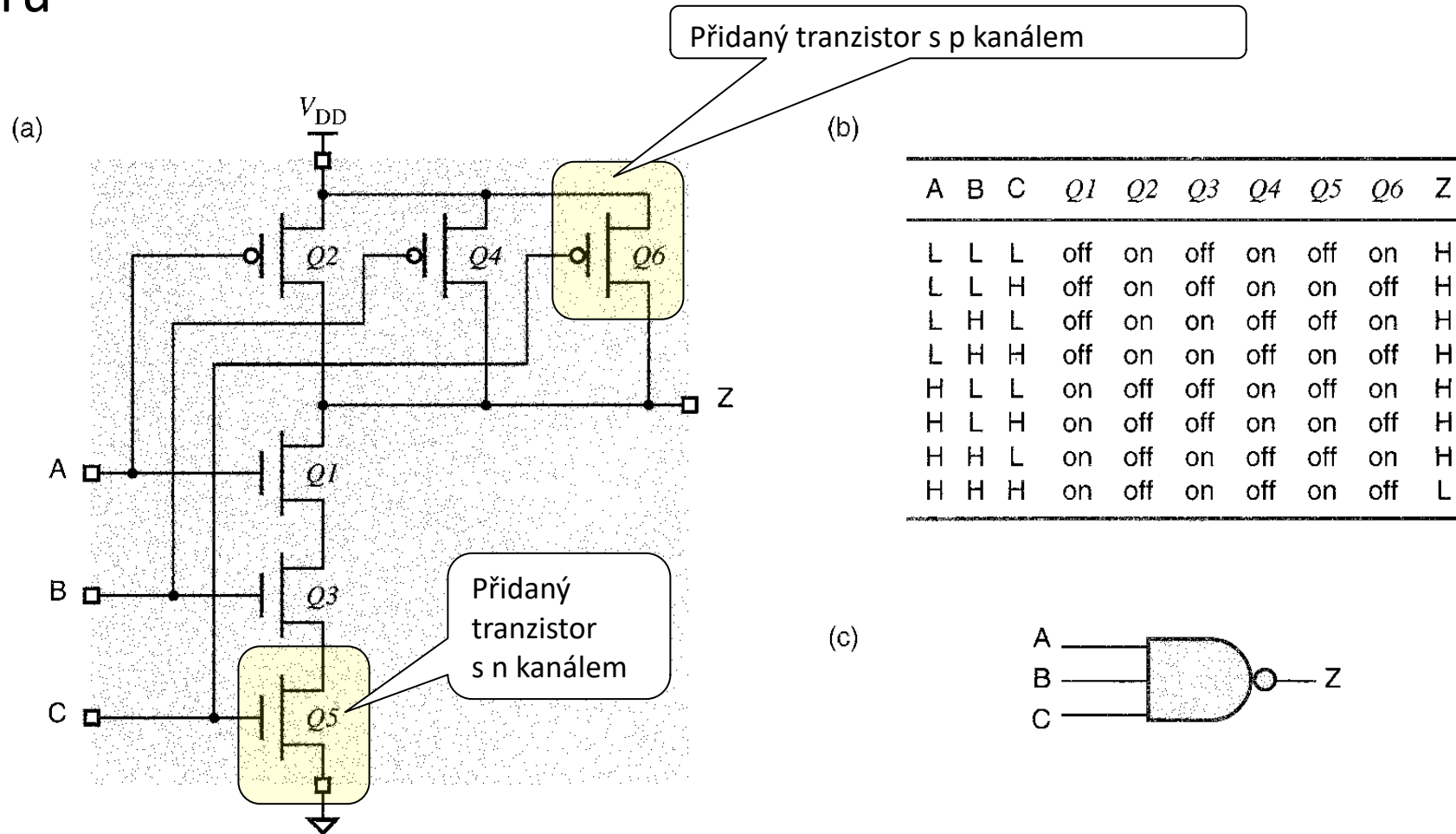
A = 1 (High), B = 0 (Low)



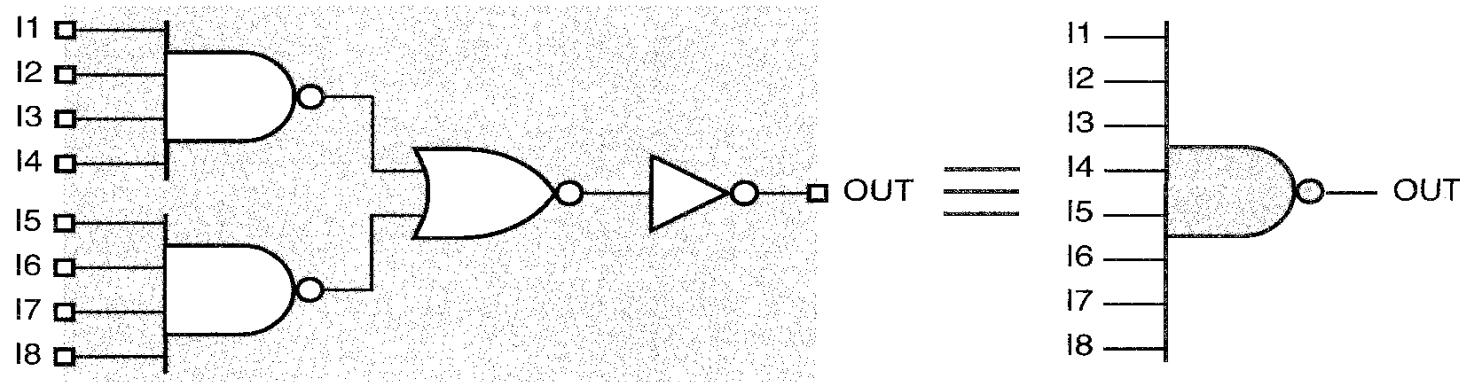
A = 1 (High), B = 1 (High)



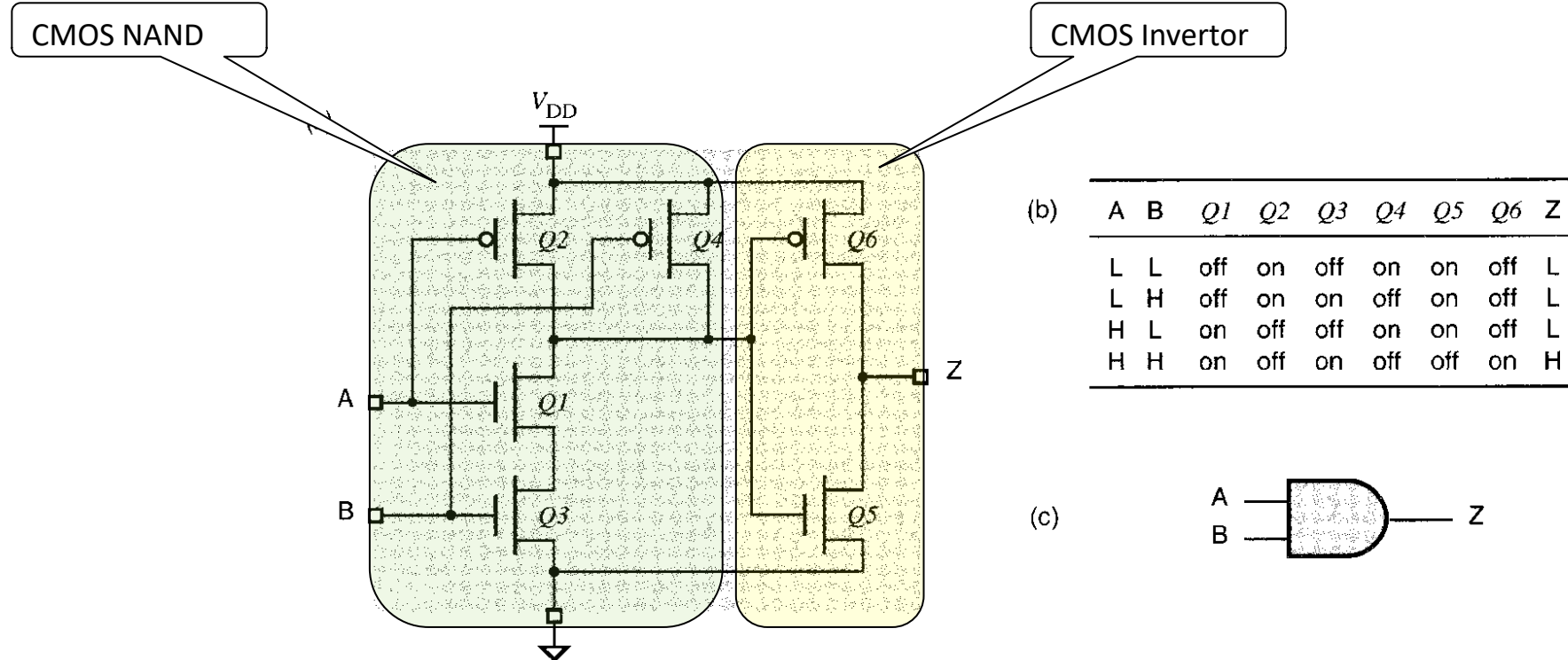
- Větší počet vstupů je možné realizovat přidáním dalších dvojic komplementárních tranzistorů



- Teoreticky je možno sestavovat log. členy s více vstupy pouhým řazením více tranzistorů MOSFET
 - Je nějak omezen počet vstupů logických členů? Jak? Kolik je maximální počet vstupů logických členů?
- Díky konečným přechodovým odporům a potřebné rychlosti odezvy je počet vstupů limitován výrobní technologií
 - U hradel NAND typicky na 6 vstupů
 - U hradel NOR typicky na 4 vstupy
- Pro každou výrobní technologii se udává parametr *Fan-in*, který určuje maximální počet vstupů logického členu vyrobeného v dané technologii
- Větší množství vstupů se realizuje pomocí kaskády log. členů s méně vstupy



- Hradlo AND lze nejjednodušeji sestavit zařazením invertoru za hradlo NAND



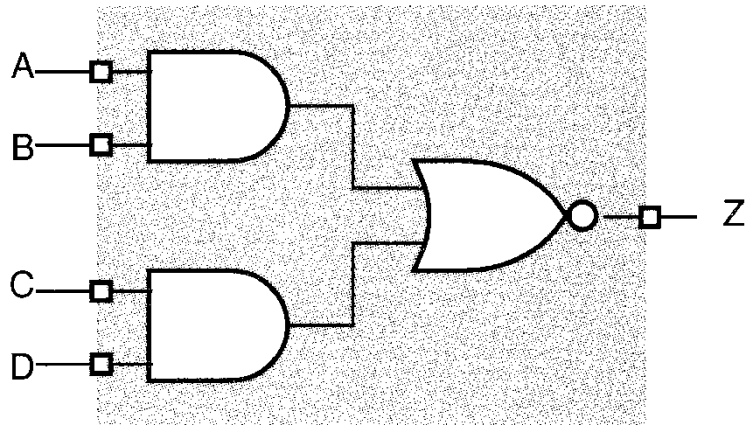
- Důsledek:
 - Složitější, dražší, větší zpoždění než NAND
 - častěji se vyrábějí invertující hradla (NAND a NOR) ...

• Příklad implementace logických forem

- V praxi se často využívají log. struktury, které realizují jistou formu disjunktivní či konjunktivní formy, a usnadňují tak implementaci kombinačních obvodů
- Výhodou je skutečnost, že zpoždění těchto obvodů je podobné jako v případě členů NAND či NOR, i když realizují dvoustupňový logický obvod

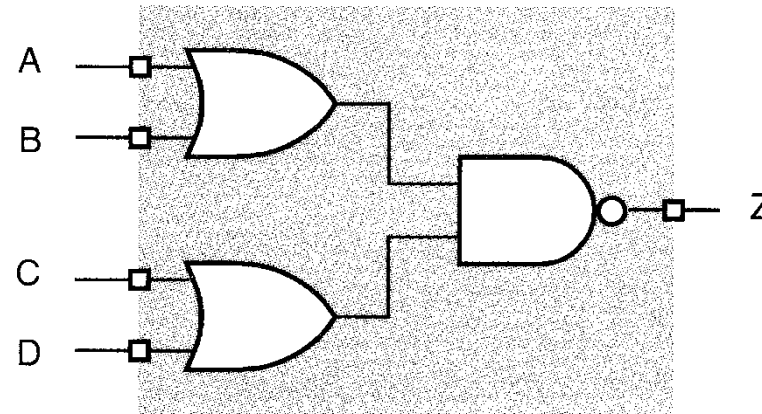
AND-OR-INVERT

- Disjunktivní forma s invertorem



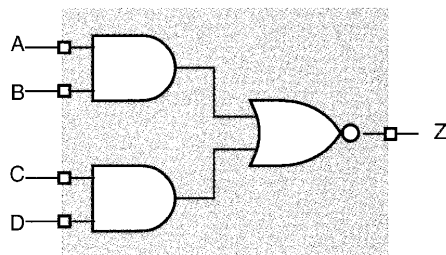
OR-AND-INVERT

- Konjunktivní forma s invertorem

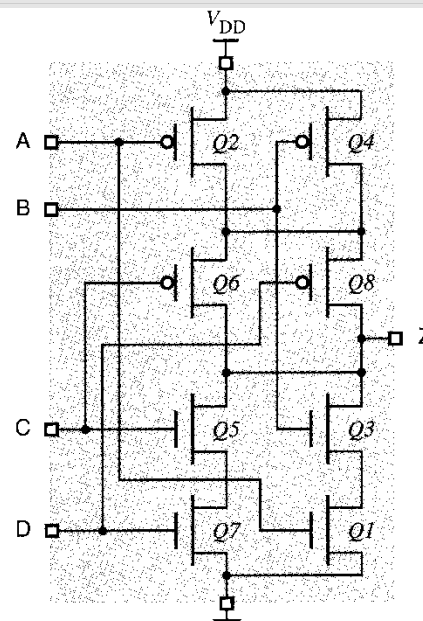


AND-OR-INVERT

(pouze 8 tranzistorů)



(a)

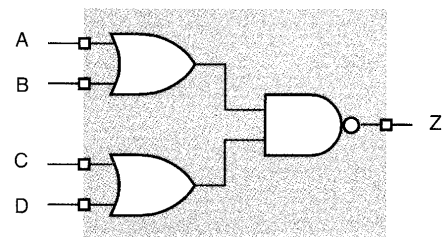


(b)

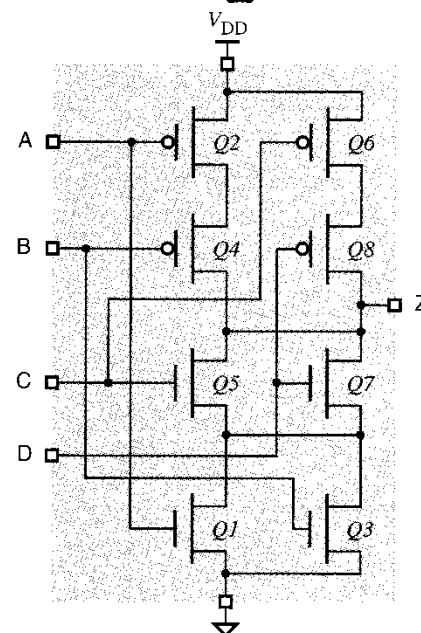
A	B	C	D	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Z
L	L	L	L	off	on	off	on	off	on	off	on	H
L	L	L	H	off	on	off	on	off	on	on	off	H
L	L	H	L	off	on	off	on	on	off	off	on	H
L	L	H	H	off	on	off	on	on	off	on	off	L
L	H	L	L	off	on	on	off	off	on	off	on	H
L	H	L	H	off	on	on	off	off	on	on	off	H
L	H	H	L	off	on	on	off	on	off	off	on	H
L	H	H	H	off	on	on	off	on	off	on	off	L
H	L	L	L	on	off	off	on	off	on	off	on	H
H	L	L	H	on	off	off	on	off	on	on	off	H
H	L	H	L	on	off	off	on	on	off	off	on	H
H	L	H	H	on	off	off	on	on	off	on	off	L
H	H	L	L	on	off	on	off	off	on	off	on	L
H	H	L	H	on	off	on	off	off	on	on	off	L
H	H	H	L	on	off	on	off	on	off	off	on	L
H	H	H	H	on	off	on	off	on	off	on	off	L

OR-AND-INVERT

(pouze 8 tranzistorů)



(a)

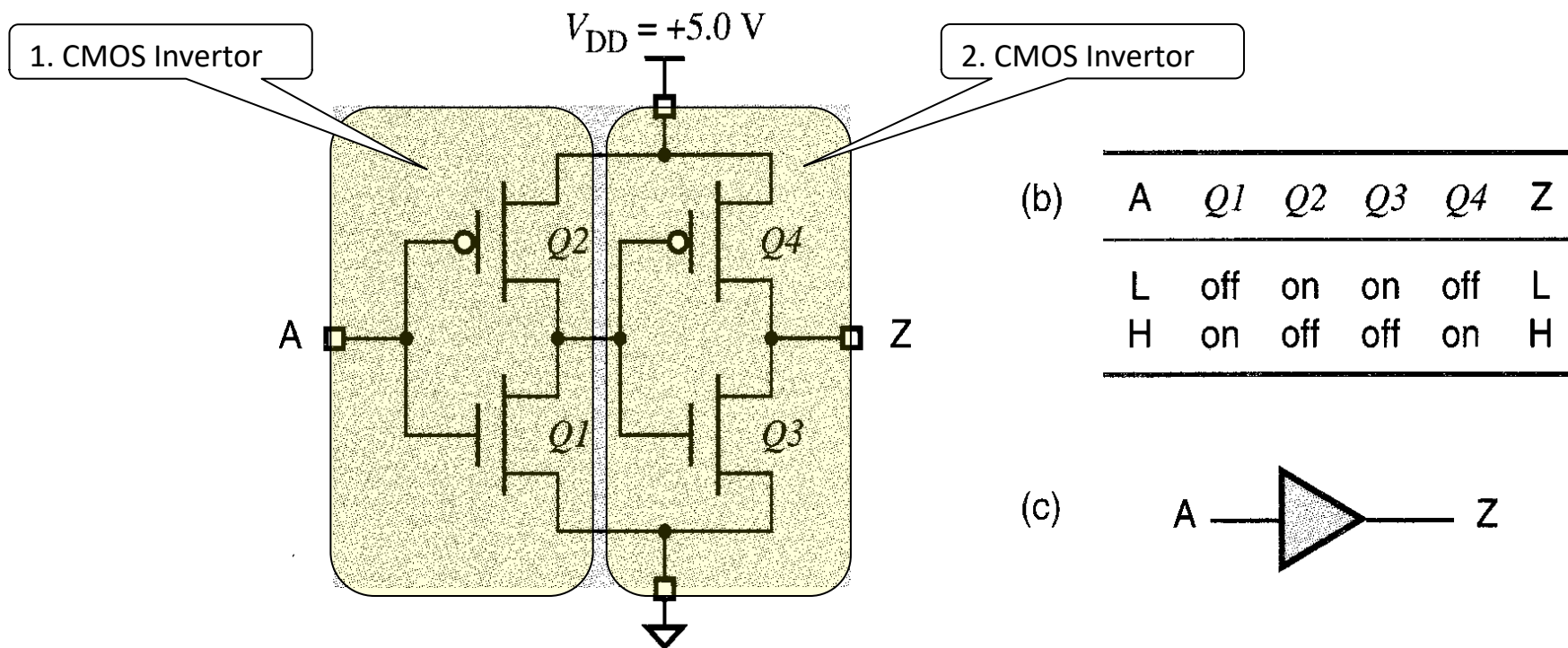


(b)

A	B	C	D	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Z
L	L	L	L	off	on	off	on	off	on	off	on	H
L	L	L	H	off	on	off	on	off	on	on	off	H
L	L	H	L	off	on	off	on	on	off	off	on	H
L	L	H	H	off	on	off	on	on	off	on	off	H
L	H	L	L	off	on	on	off	off	on	on	off	L
L	H	H	L	off	on	on	off	on	off	off	on	L
L	H	H	H	off	on	on	off	on	off	on	off	L
H	L	L	L	on	off	off	on	off	on	off	on	H
H	L	L	H	on	off	off	on	off	on	on	off	L
H	L	H	L	on	off	off	on	on	off	off	on	L
H	L	H	H	on	off	off	on	on	off	on	off	L
H	H	L	L	on	off	on	off	off	on	off	on	H
H	H	L	H	on	off	on	off	off	on	on	off	L
H	H	H	L	on	off	on	off	on	off	off	on	L
H	H	H	H	on	off	on	off	on	off	on	off	L

- Zařazením dvou invertorů za sebe vznikne tzv. buffer

- Slouží pro distribuci signálu tam, kde je např. třeba obnovit integritu signálu, budit více vstupů následujících log. členů (hodinový signál), apod.

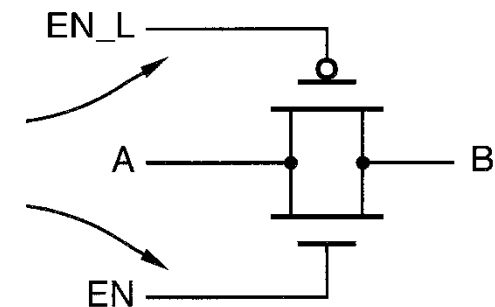


- Přenosový člen (anglicky „transmission gate“)

- Funguje jako řízený spínač

- Je sestaven z komplementárních tranzistorů

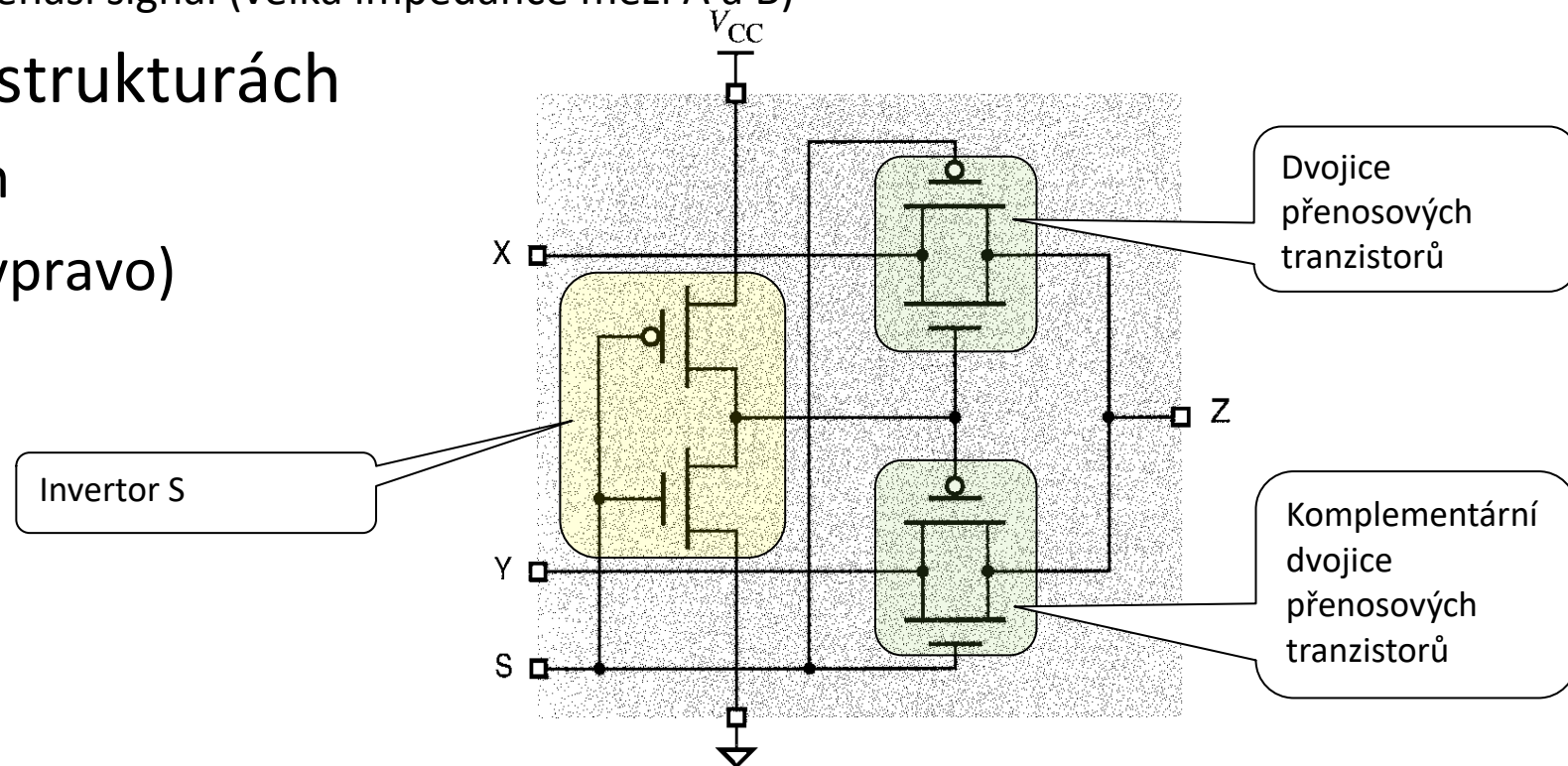
- Oba jsou otevřeny – člen přenáší signál (malá impedance mezi A a B)
 - Oba jsou zavřeny – člen nepřenáší signál (velká impedance mezi A a B)



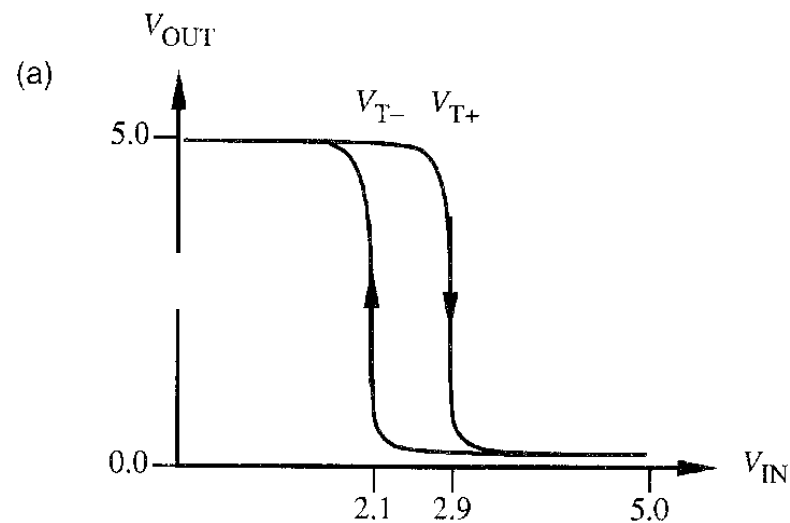
- Používá se v složitějších strukturách

- Např. klopných obvodech

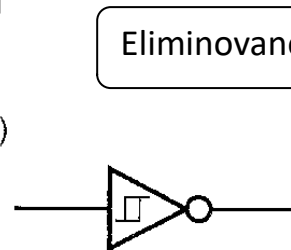
- Multiplexorech (viz obr. vpravo)



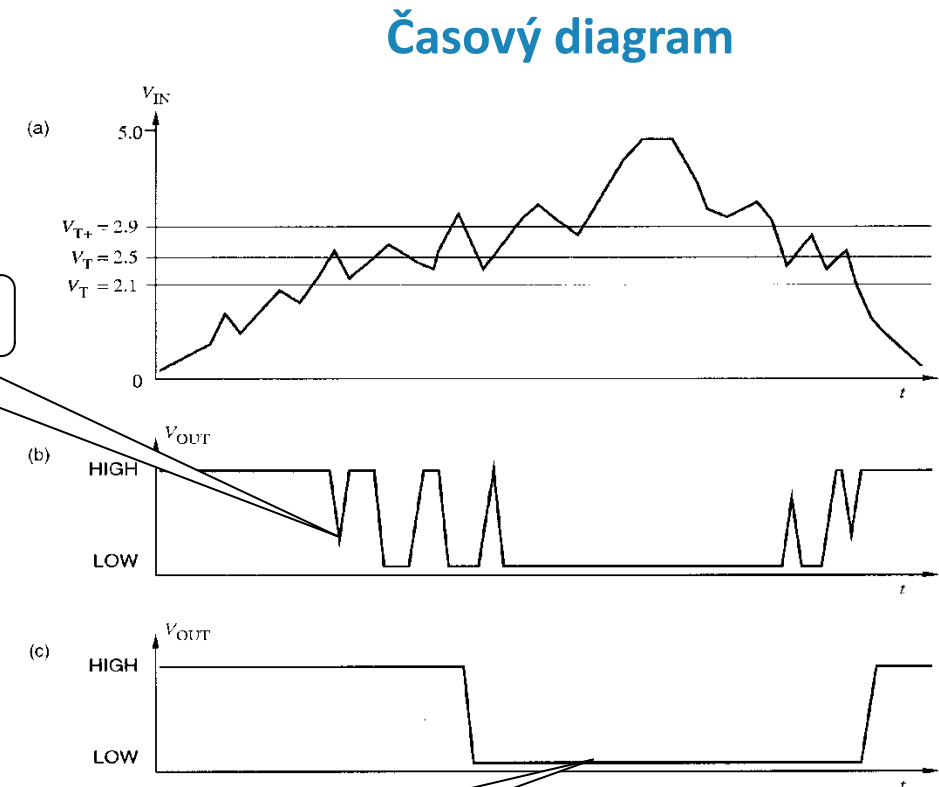
- Využívá vnitřní zpětné vazby pro posun prahových úrovní podle toho, do které úrovně přechází
 - L do H ... větší hodnota (např. 2,9 V)
 - H do L ... menší hodnota (např. 2,1 V)
- ***Tento jev nazýváme hysterezí***
 - Zlepšuje šumovou odolnost obvodů



Přenosová charakteristika obvodu

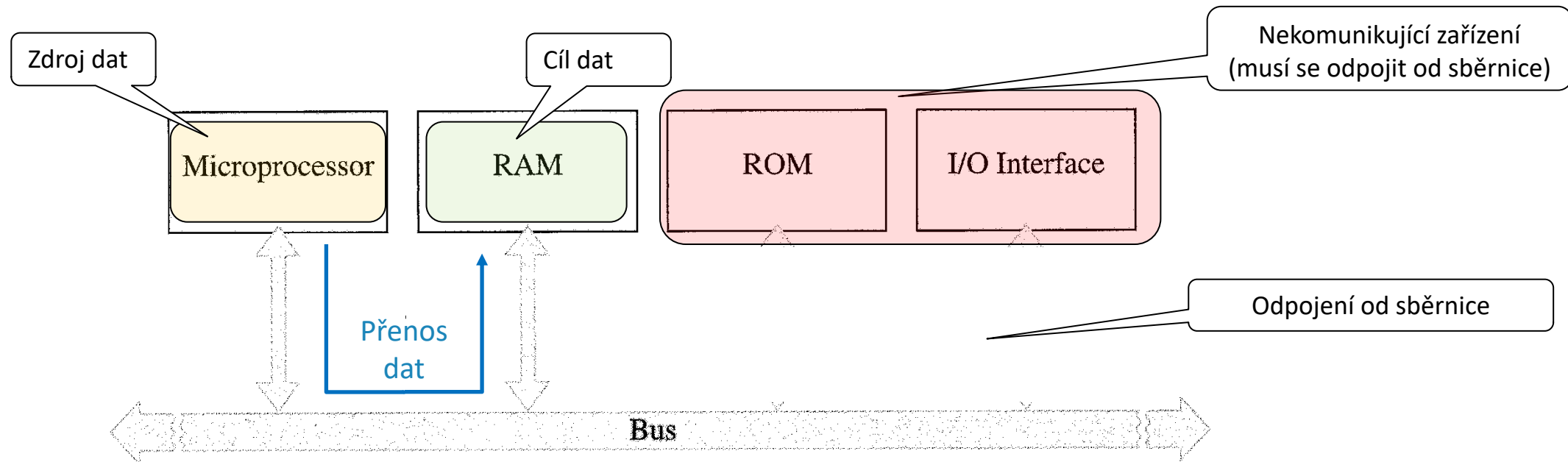


Schématická značka



Hladký průběh způsobený hysterezí

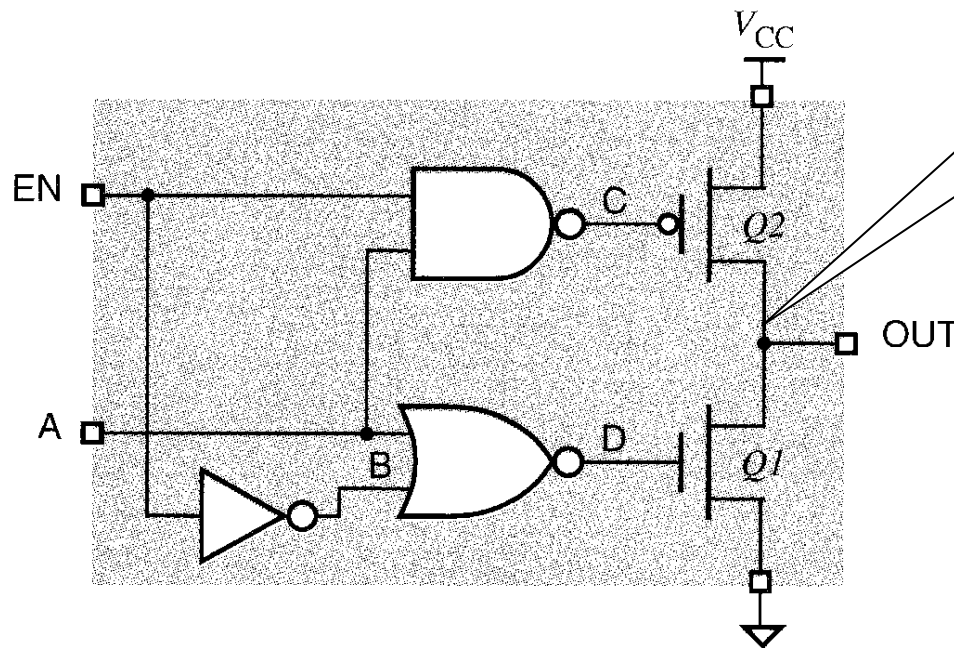
- Jednotlivé subsystémy typického počítače jsou propojeny sběrnicí
- V jednom okamžiku se přenáší data z jednoho zdroje do jednoho cíle - datové přenosy jsou přepínány v čase (pomalé)
- Výsledkem je zjednodušení propojovací infrastruktury



**Pro připojování a odpojování od sběrnice potřebujeme
třístavové budiče**

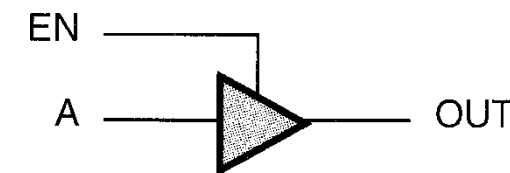
- Anglicky „three-state buffer” nebo „tri-state buffer”

- Umožňuje odpojit výstup obvodu, dát výstup do stavu tzv. vysoké impedance („high impedance”, Z)
- Obvod má tedy tři stavy – L, H a Z
- Typicky se používá pro realizaci sběrnic



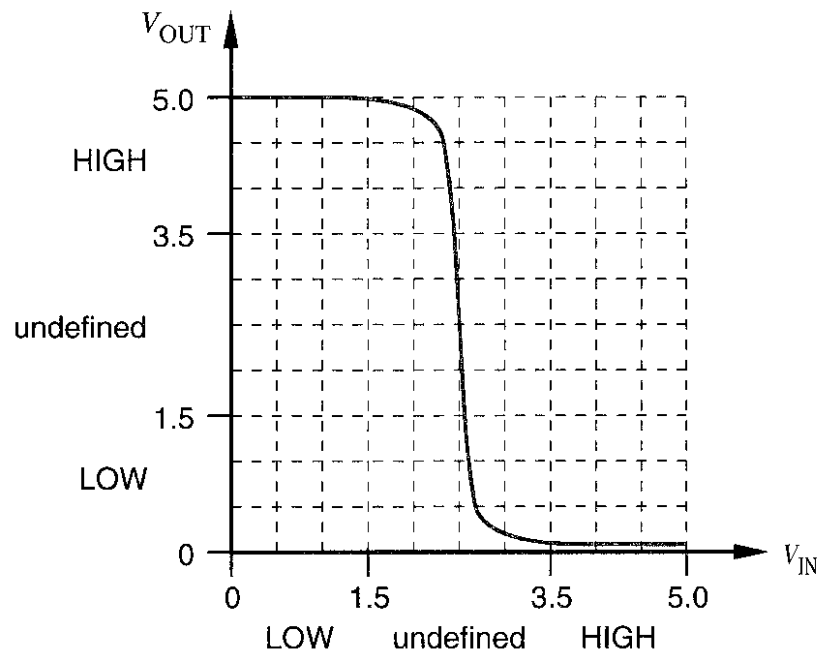
EN='0' uzavře tranzistory Q_1 a Q_2 současně $\rightarrow$ OUT='Z'

EN	A	B	C	D	$Q1$	$Q2$	OUT
L	L	H	H	L	off	off	Hi-Z
L	H	H	H	L	off	off	Hi-Z
H	L	L	H	H	on	off	L
H	H	L	L	L	off	on	H



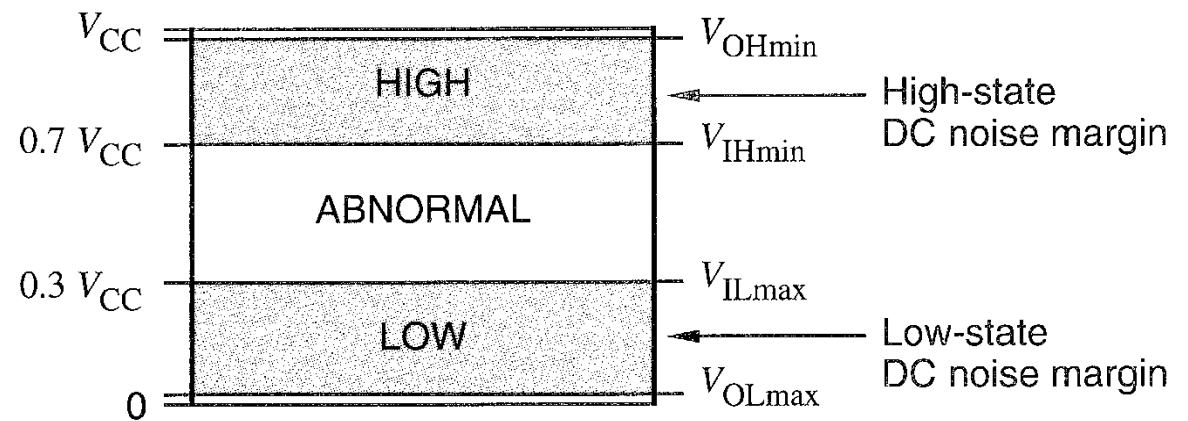
• Převodní charakteristika CMOS invertoru

- 5V napájení
- V_{IN} - vstupní napětí
- V_{OUT} - výstupní napětí

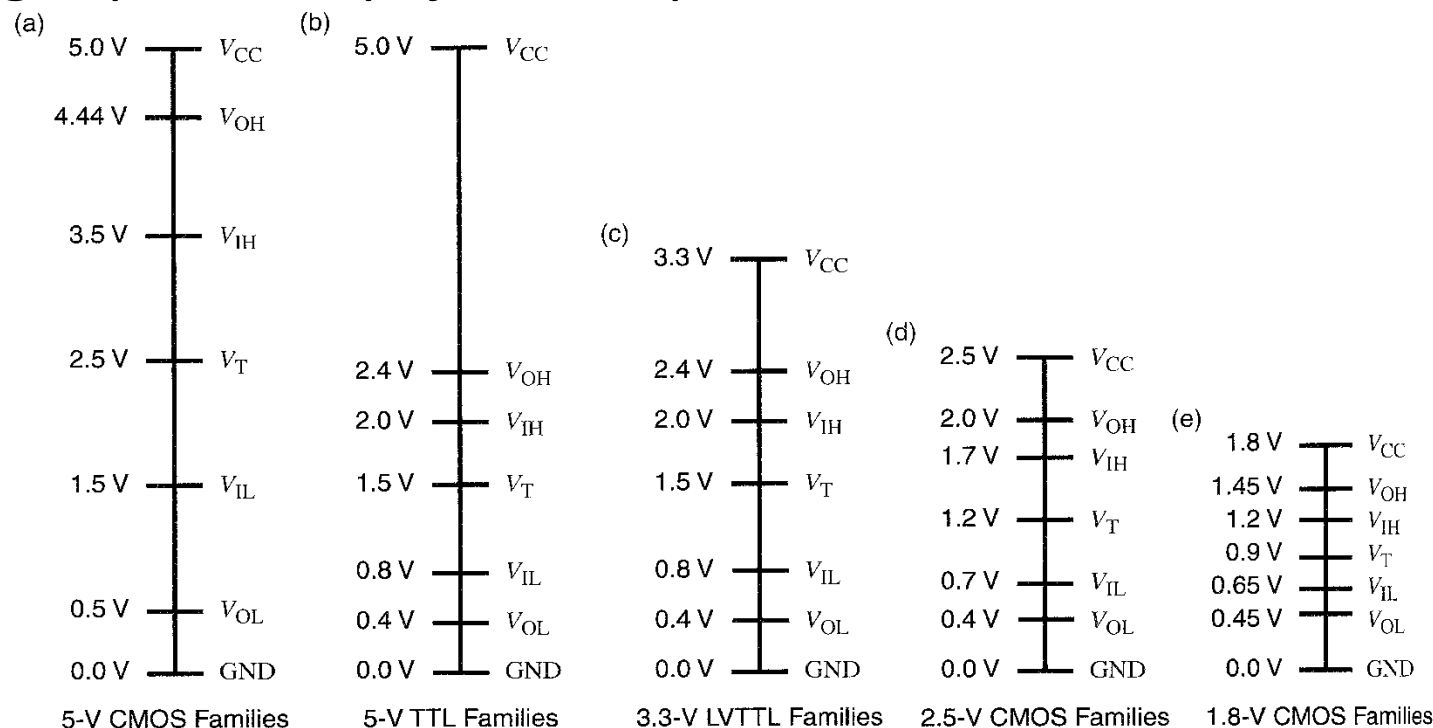


• Příklad CMOS HC - logické úrovně a rozsah odolnosti proti rušení (noise margins)

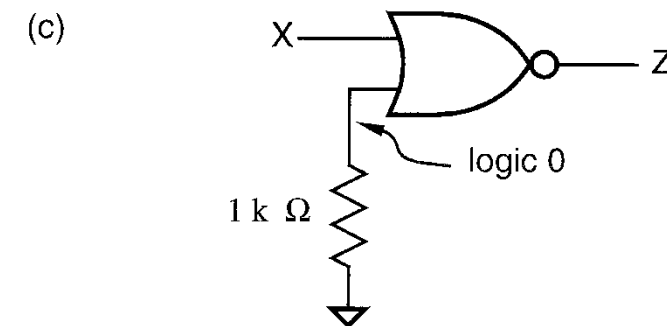
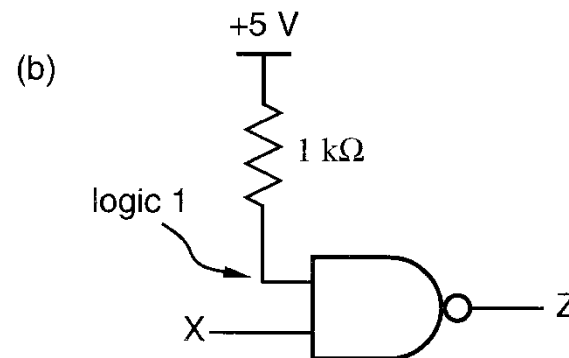
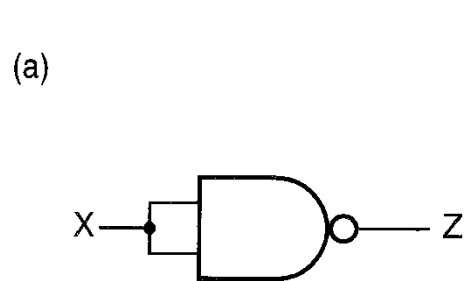
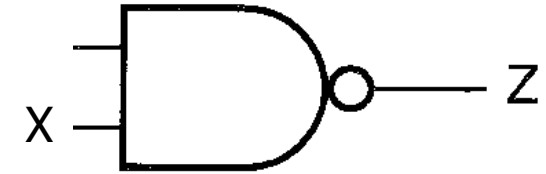
- V_{CC} napájecí napětí
- V_{OHmin} min. výstupní napětí H = $V_{CC} - 0,1 V$
- V_{IHmin} min. vstupní napětí H = 70 % V_{CC}
- V_{ILmax} max. vstupní napětí L = 30 % V_{CC}
- V_{OLmax} max. výstupní napětí L = zem + 0,1 V



- Dnešním trendem je snižování příkonu a zvyšování rychlosti
- Napájecí napětí určuje řadu parametrů obvodů
 - Vyšší napájecí napětí = větší příkon a rychlost
 - Nižší napájení = menší odolnost proti rušení („noise margin“)
- Příklad technologií spolu s napájecím napětím a rozhodovacími úrovněmi



- Jak ošetřit nevyužité vstupy logických obvodů?
 - Obvod je třeba připojit na takové log. úrovně, které neovlivní chování obvodu a zajistí, že vstup nebude náchylný k rušení
- Způsob ošetření
 - Připojení k jiným vstupům (a)
 - Vstup hradla NAND na zdroj log. 1 – napájecí napětí přes ochranný rezistor (b)
 - Vstup hradla NOR na zdroj log. 0 – zem napájecího napětí přes rezistor, případně přímo (c)



- Logické úrovně

- Log. členy jsou konstruovány tak, aby byly za normálních podmínek (teplota, napájecí napětí, rušení, atd.) schopny generovat log. úrovně v jistém intervalu hodnot a též rozlišovat log. úrovně v určitém rozmezí hodnot

- Odolnost proti rušení (DC Noise Margins)

- Je zajištěna v určitém rozmezí tak, že log. člen je schopen akceptovat větší rozptyl vstupních hodnot log. úrovní, než jaký generuje na výstupu
- Rušení může být generováno např. kosmickým zářením, elektromagnetickým polem, kolísáním napájecího napětí apod.

- Logický zisk (Fan-Out)

- Počet vstupů log. členů, které můžeme zapojit na výstup daného členu, při kterém jsou ještě zaručeny správné hodnoty log. úrovní pro celý rozsah pracovních podmínek (napájecí napětí, teplota)

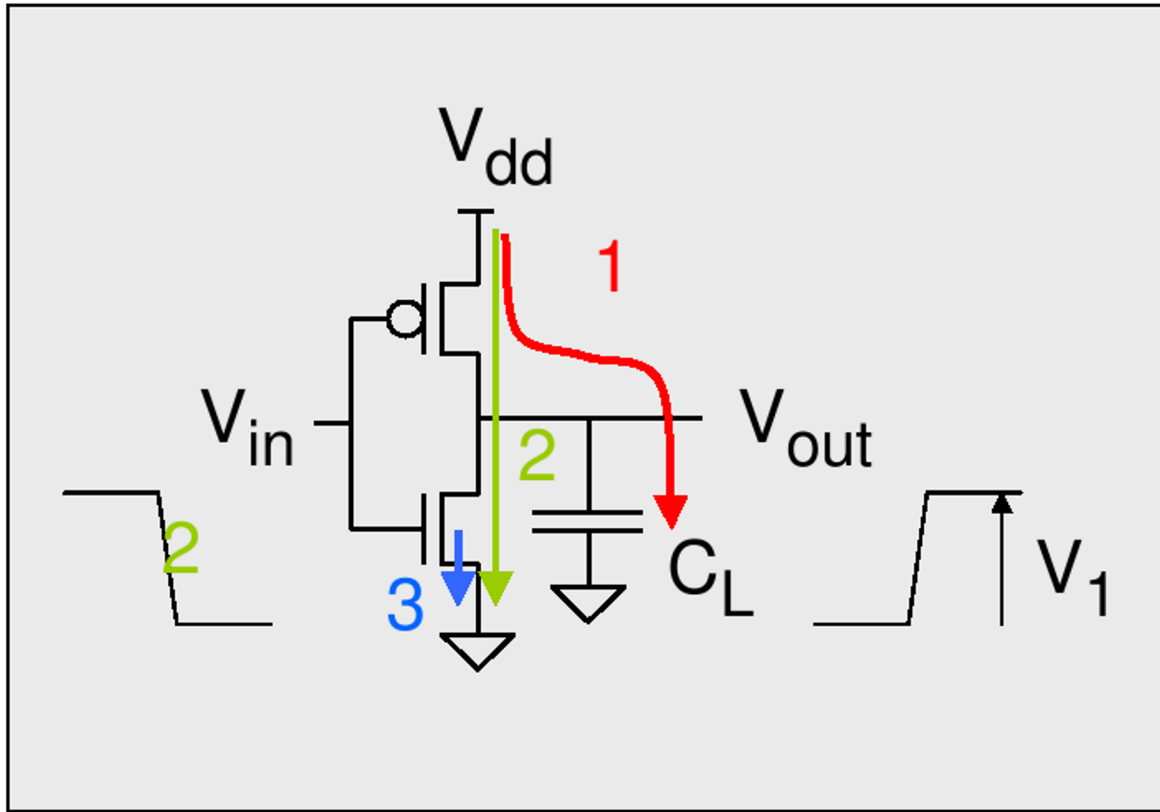
- Rychlost

- Doba, které je třeba k přechodu signálu ze vstupu na výstup
- Dána dobami přechodů mezi log. úrovněmi a dobou průchodu signálu
- Závisí na konstrukci log. členů, na počtu jiných log. členů zapojených na jeho výstup, na délce vodičů, na konstrukci desky s plošnými spoji atd.

- Příkon

- Závisí na konstrukci log. členu, na počtu členů, frekvenci změn log. úrovní, parazitních atd.

- Technologie CMOS
- *Příkon v technologii CMOS*
- Programovatelné struktury (PLD)
- Technologie FPGA



1. Dynamický / Aktivní příkon

- Nabíjení a vybíjení parazitní kapacity C_L

2. Příkon způsobený „zkraty“

- Při přepnutí tranzistoru vzniká přímá cesta mezi VDD a GND

3. Statický / Leakage příkon

- Zbytkové proudy tranzistorů

- Náboj $Q = C \cdot U [C] = I \cdot t [As]$
- Energie $E = 1/2 \cdot Q \cdot U = 1/2 \cdot C \cdot U^2 [J = Ws]$

- Nabíjení $E_C = E_{RN} = 1/2 \cdot C \cdot U^2$

- Vybíjení $E_C = E_{RV} = 1/2 \cdot C \cdot U^2$

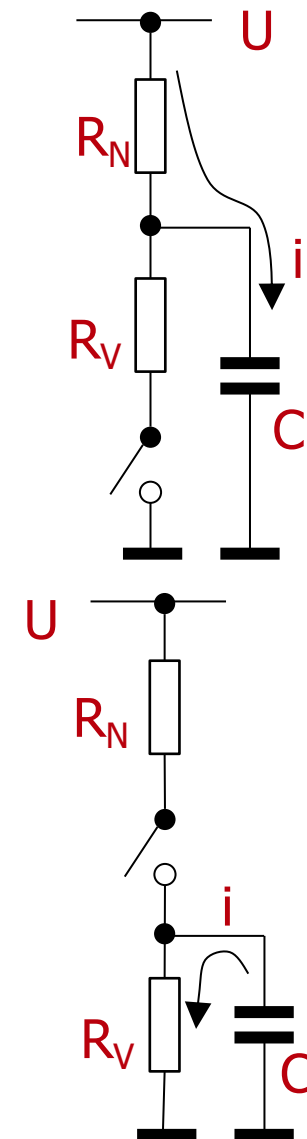
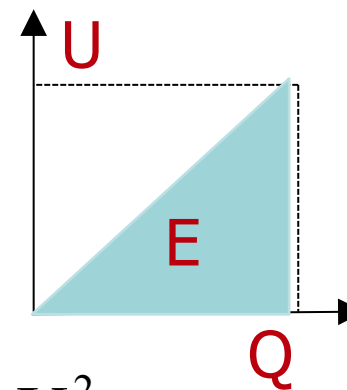
- Energie nabití/vybití

$$E_{0 \rightarrow 1 \rightarrow 0} = E_{RN} + E_{RV} = C \cdot U^2$$

- Příkon při periodickém nabíjení/vybíjení

$$P[W] = \frac{E[Ws]}{t[s]} = E[Ws] \cdot f[Hz] = C \cdot U^2 \cdot f$$

➤ f... frekvence změn 0-1-0 (frekvence hodinového signálu)



- Dynamický příkon

$$P_{dynamic} = \alpha \cdot C \cdot V_{DD}^2 \cdot f_{clk}$$

- Spotřeba energie

$$E_{dynamic} = \alpha \cdot C \cdot V_{DD}^2 \cdot S$$

- α – pravděpodobnost přepnutí logické úrovně hradla
- C – zátěžová kapacita
- V_{DD} – napájecí napětí
- f_{clk} – frekvence hodin

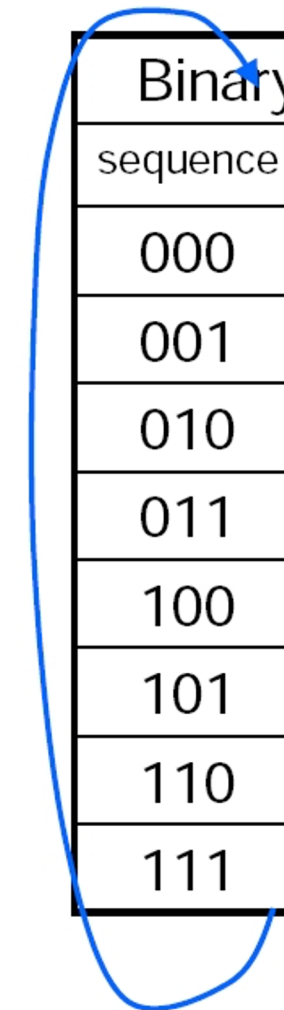
S – počet taktů hodin

- Zpoždění

$$\tau_c(U) = k' \cdot C \cdot \frac{V_{DD}}{(V_{DD} - V_T)^2}$$

V_T – prahové napětí

- Koeficient α je možné ovlivnit
 - Zastavením signálu hodin (Clock gating)
 - *Pomocí vhodného kódování*
- Počet změn při čítání v binárním kódu vs čítání v Grayovu kódu
- Je nutné vzít do úvahy i parametry kódovací a dekódovací logiky



Binary Code		Gray Code	
sequence	# toggles	sequence	# toggles
000	3	000	1
001	1	001	1
010	2	011	1
011	1	010	1
100	3	110	1
101	1	111	1
110	2	101	1
111	1	100	1

- Příklad: snížení napájecího napětí na polovinu

- *Příkon klesne 4x*

$$P_{(V_{DD}/2)} = \alpha \cdot f \cdot C \cdot (V_{DD} / 2)^2 = 1/4 \cdot \alpha \cdot f \cdot C \cdot V_{DD}^2 = P / 4$$

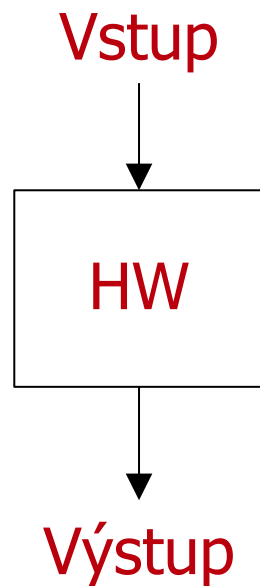
- *Zpoždění vzroste 2x*

$$\tau_{(V_{DD}/2)} \approx \frac{1}{\frac{V_{DD}}{2}} = 2 \cdot \frac{1}{V_{DD}} = 2 \cdot \tau$$

**Snížení příkonu je možné pomocí dynamické změny napětí a frekvence
(DVFS - Dynamic Voltage and Frequency Scaling)**

- Příklad: Výpočet jednou výpočetní jednotkou

- $f=1 \text{ GHz}$, $V_{DD} = 2 \text{ V}$

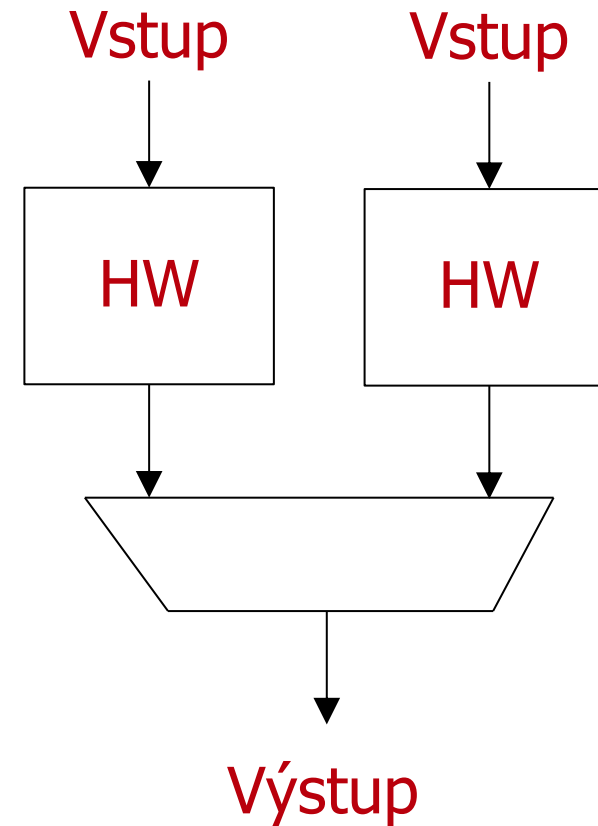


$$P_1 = C \cdot 2^2 \cdot f = 4 \cdot C \cdot f$$

$$P_2 = 2 \cdot C \cdot 1^2 \cdot f / 2 = C \cdot f = P_1 / 4$$

- Příklad: Výpočet dvěma identickými jednotkami

- $f=500 \text{ MHz}$, $V_{DD} = 1 \text{ V}$



- Technologie CMOS
- Příkon v technologii CMOS
- *Programovatelné struktury (PLD)*
- Technologie FPGA

- ***Programovatelný logický obvod***

- Anglicky Programmable Logic Device (PLD)
- Mají předdefinovanou strukturu, kterou lze různým způsobem programovat pro realizaci log. obvodů
- PLD mohou též obsahovat klopné obvody, třístavové budiče, paměti atd.

- **Jakým způsobem je možné obvody programovat?**

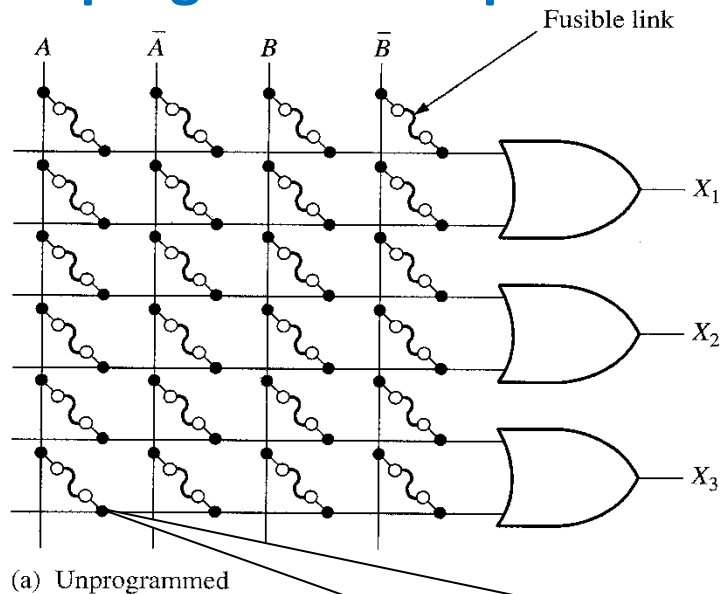
- Přepálením „pojistky“ – PAL, PLA
- Naprogramováním paměťových buněk PROM – GAL, CPLD
- Naprogramováním paměti SRAM – FPGA
- Provádí se pomocí programátoru či přímo v zařízení pomocí specializovaného rozhraní

- **Výhody programovatelných obvodů**

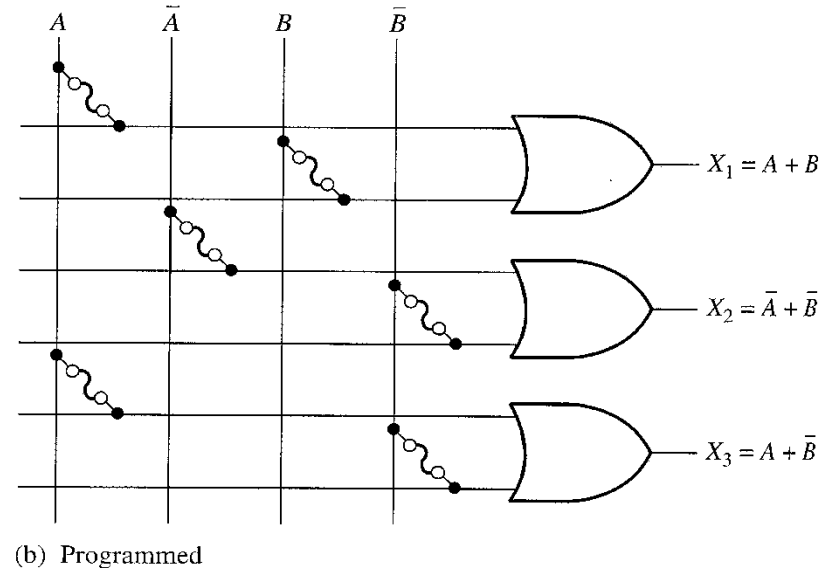
- Uživatel si může realizovat složité log. obvody sám
- V případě uložení konfigurace v paměti je možné obvody modifikovat
- Dnešní kapacity PLD obvodů jsou velmi velké (miliony ekvivalentních členů NAND)

- Pole hradel OR s programovatelným propojením na vstupní proměnné v přímé i negované podobě (invertor není zakreslen)
- Umožňují efektivně realizovat konjunktní formu

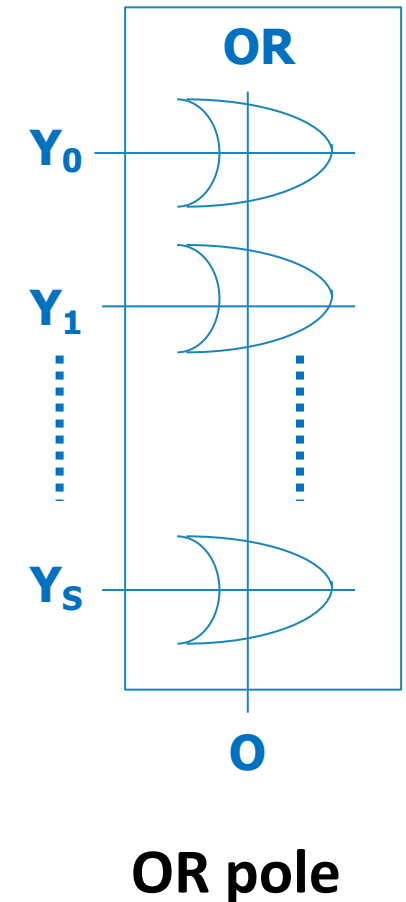
Nenaprogramované pole OR



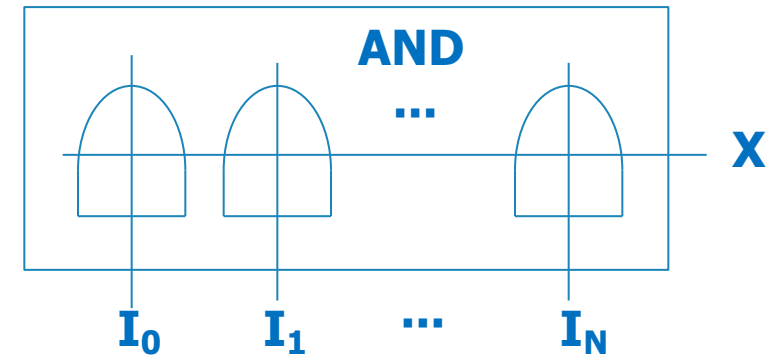
Naprogramované pole OR



Tavné propojky, definují propojení.

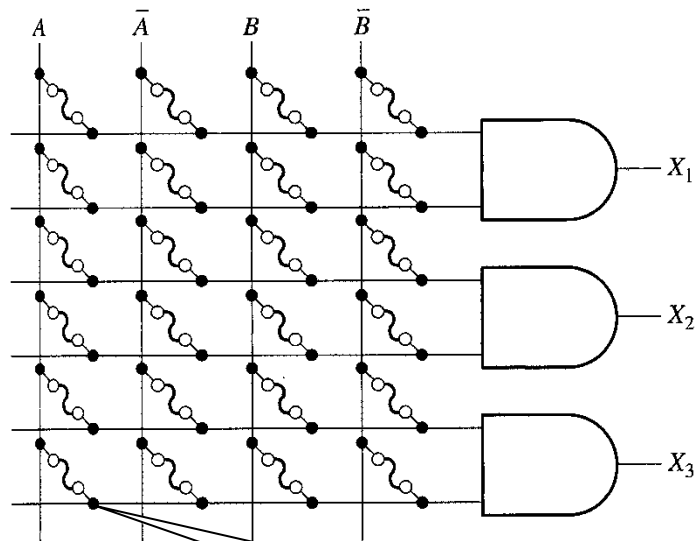


- Pole hradel AND s programovatelným propojením na vstupní proměnné v přímé i negované podobě (invertor není zakreslen)
- Umožňují efektivně realizovat disjunktční formu



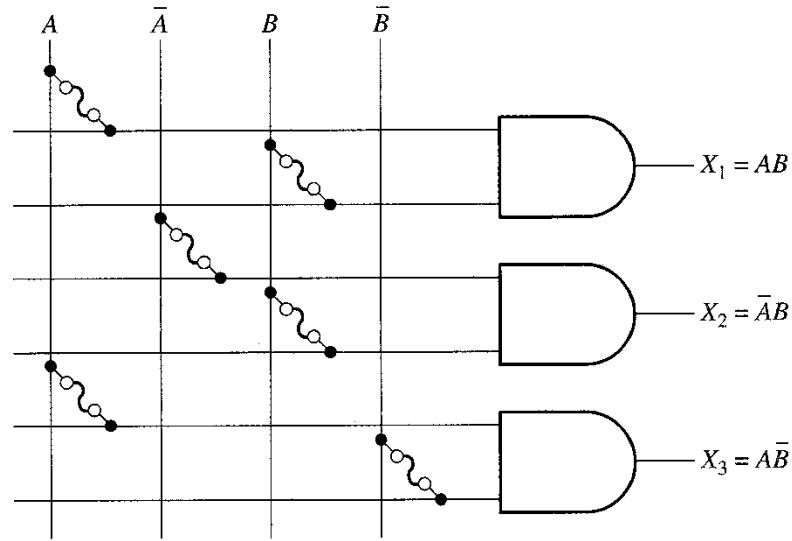
AND pole

Nenaprogramované pole OR



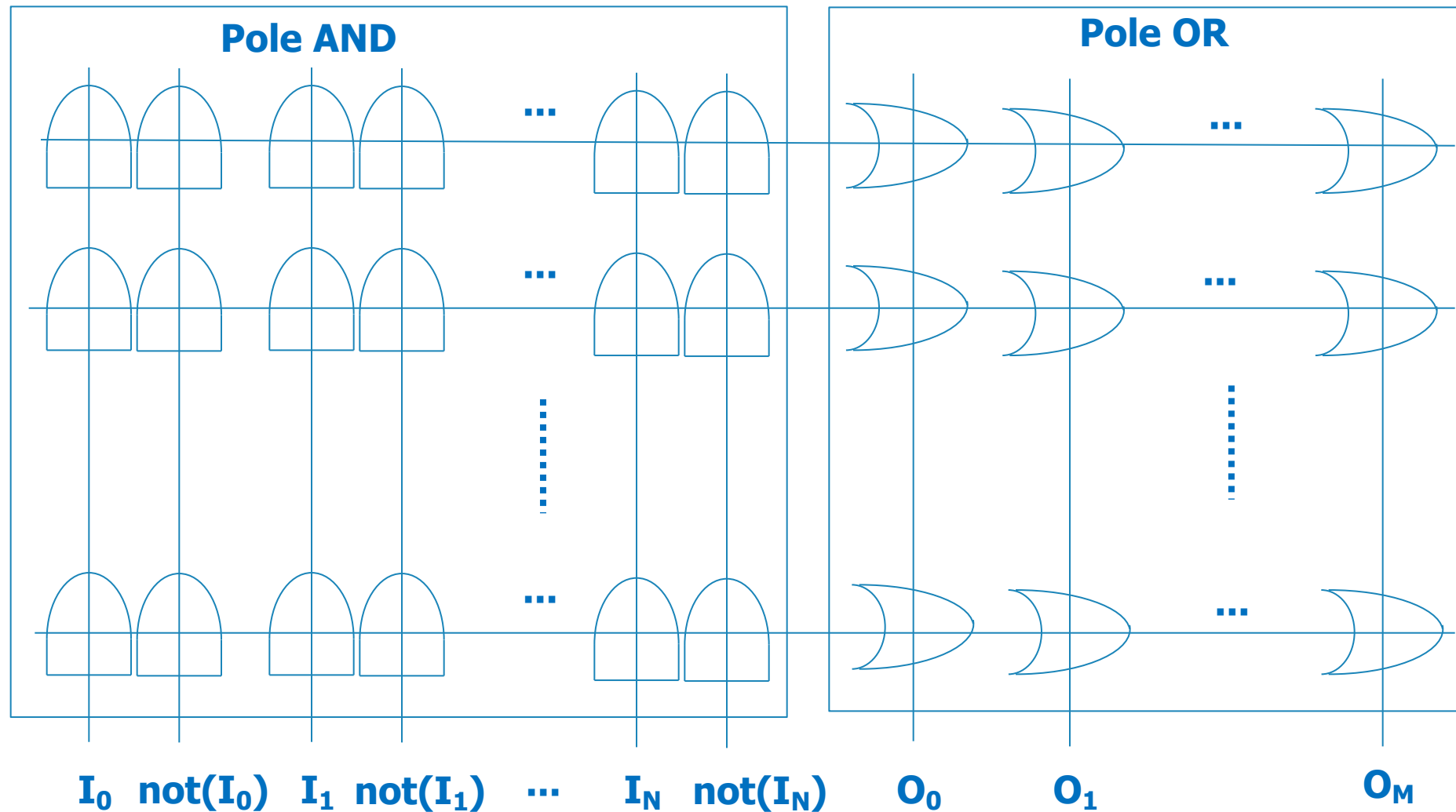
(a) Unprogrammed

Naprogramované pole OR

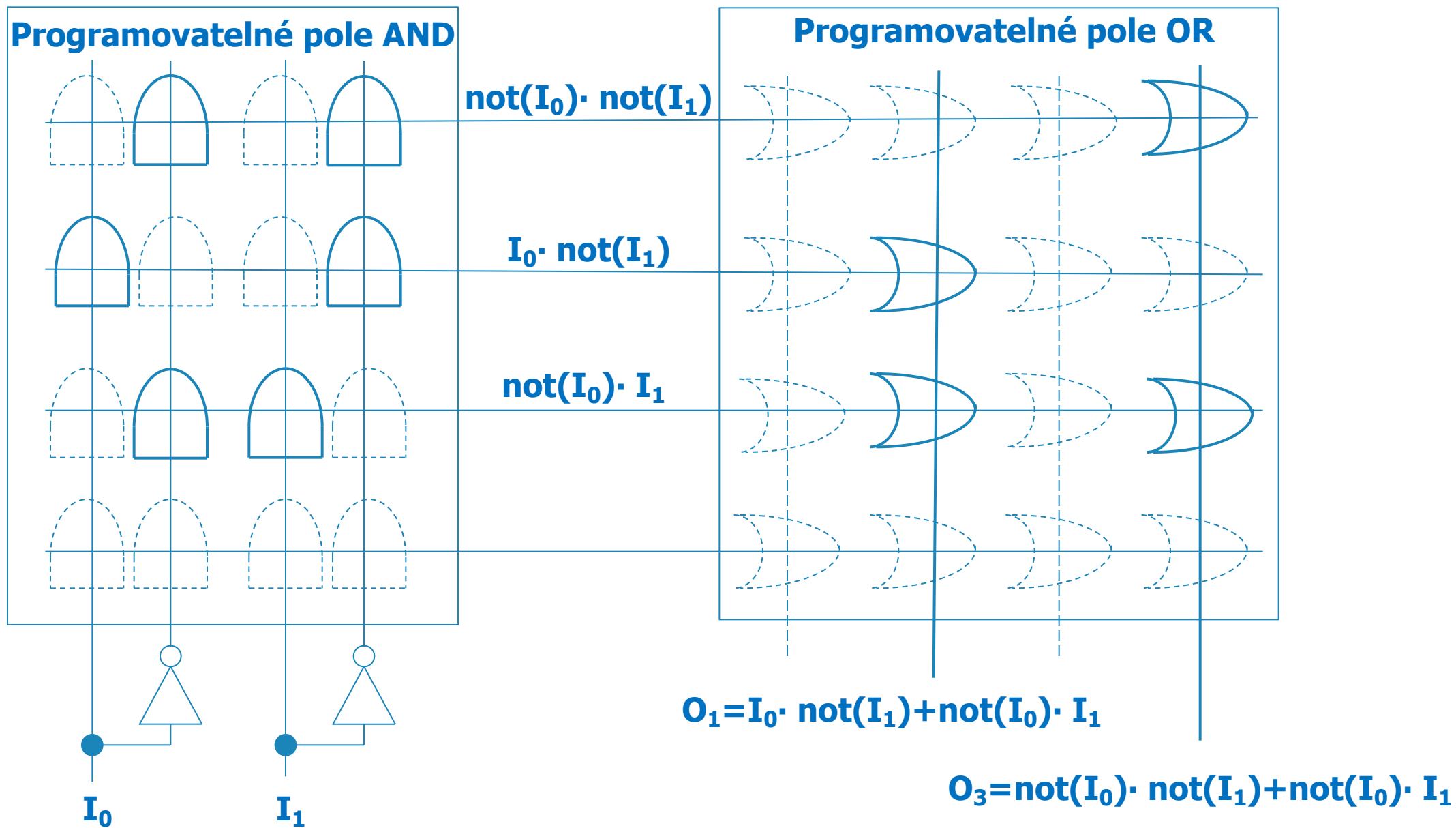


(b) Programmed

Tavné propojky, definují propojení.

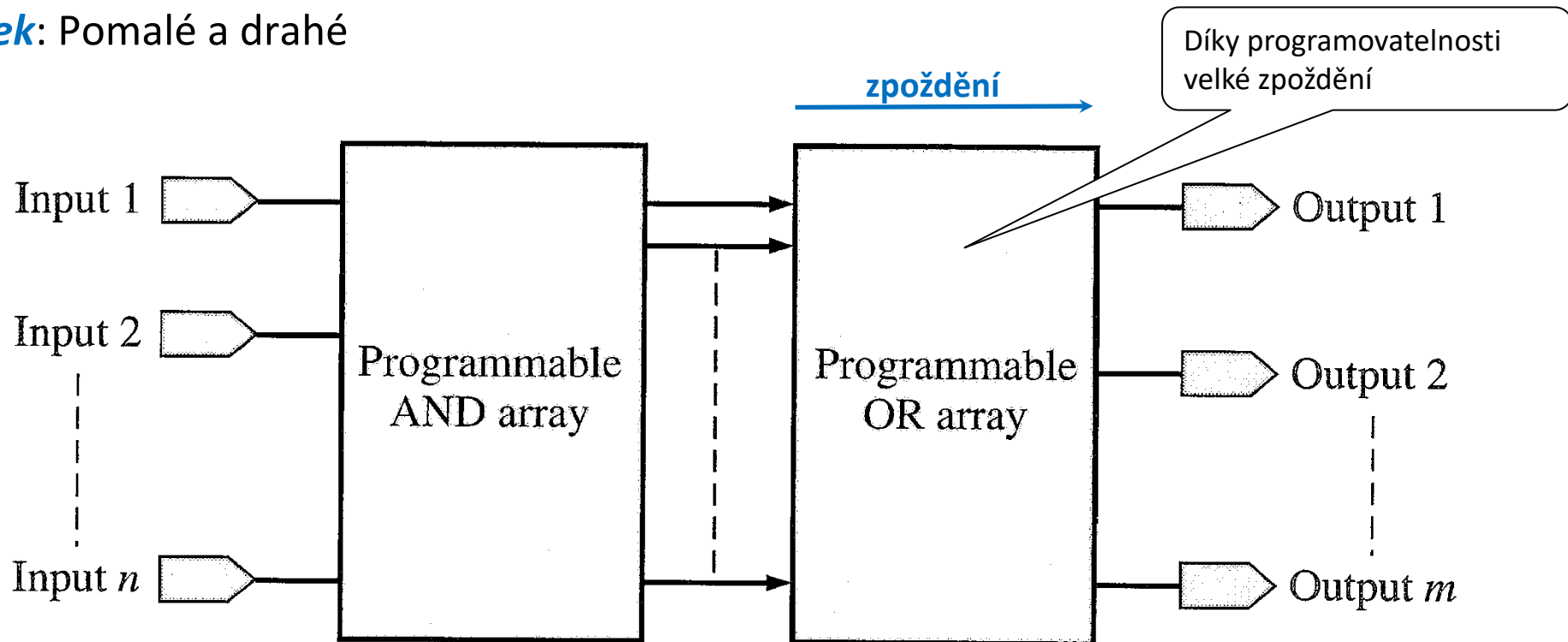


Duálně platí, že pole OR-AND implementuje součin sum (Úplná normální konjunktivní forma, POS)



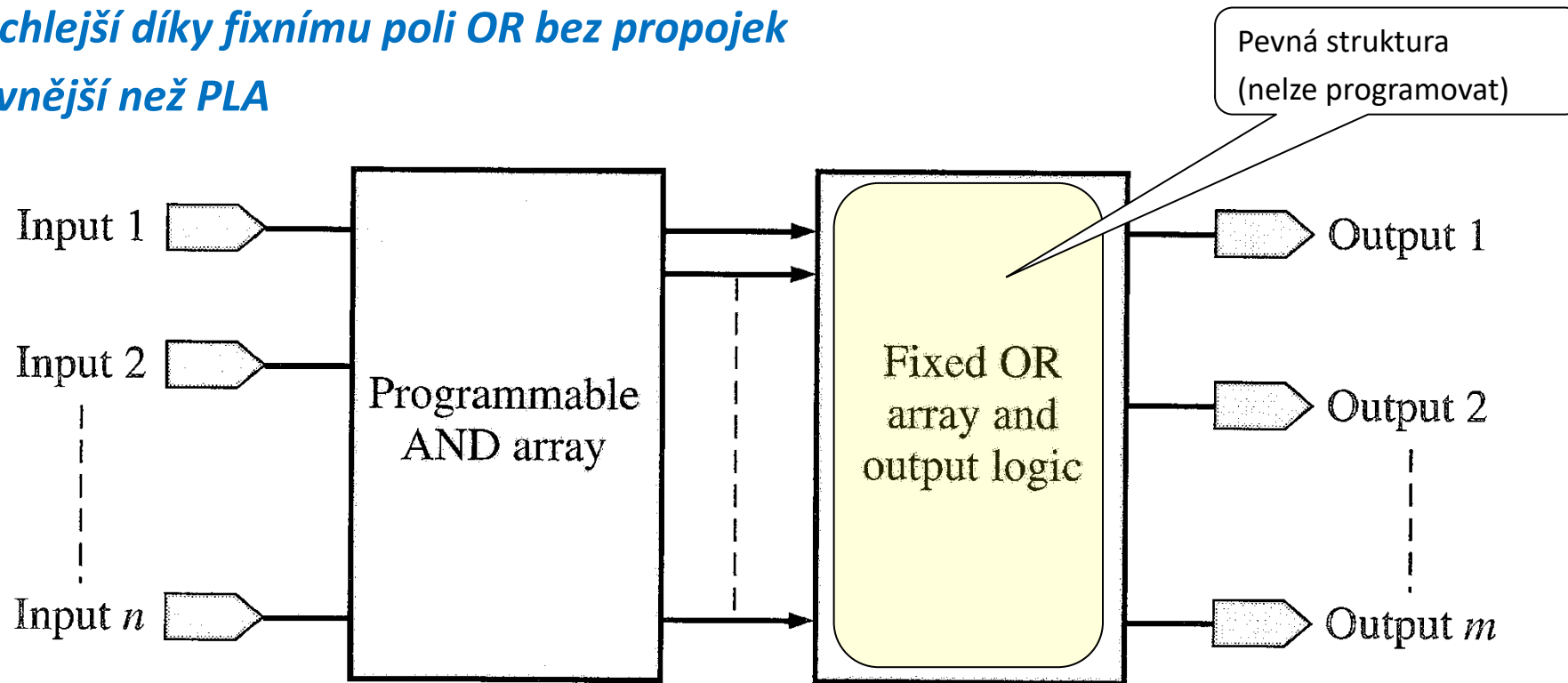
• Programmable Logic Array (PLA)

- Obě pole jsou programovatelná
- Výhodou je plná programovatelnost obou polí
- Nevýhodou je větší zpoždění kvůli programovacím propojkám („pojistkám“) v obou polích, které mají větší zpoždění než vodiče a log. členy díky přechodovému odporu a parazitním kapacitám
- **Důsledek:** Pomalé a drahé

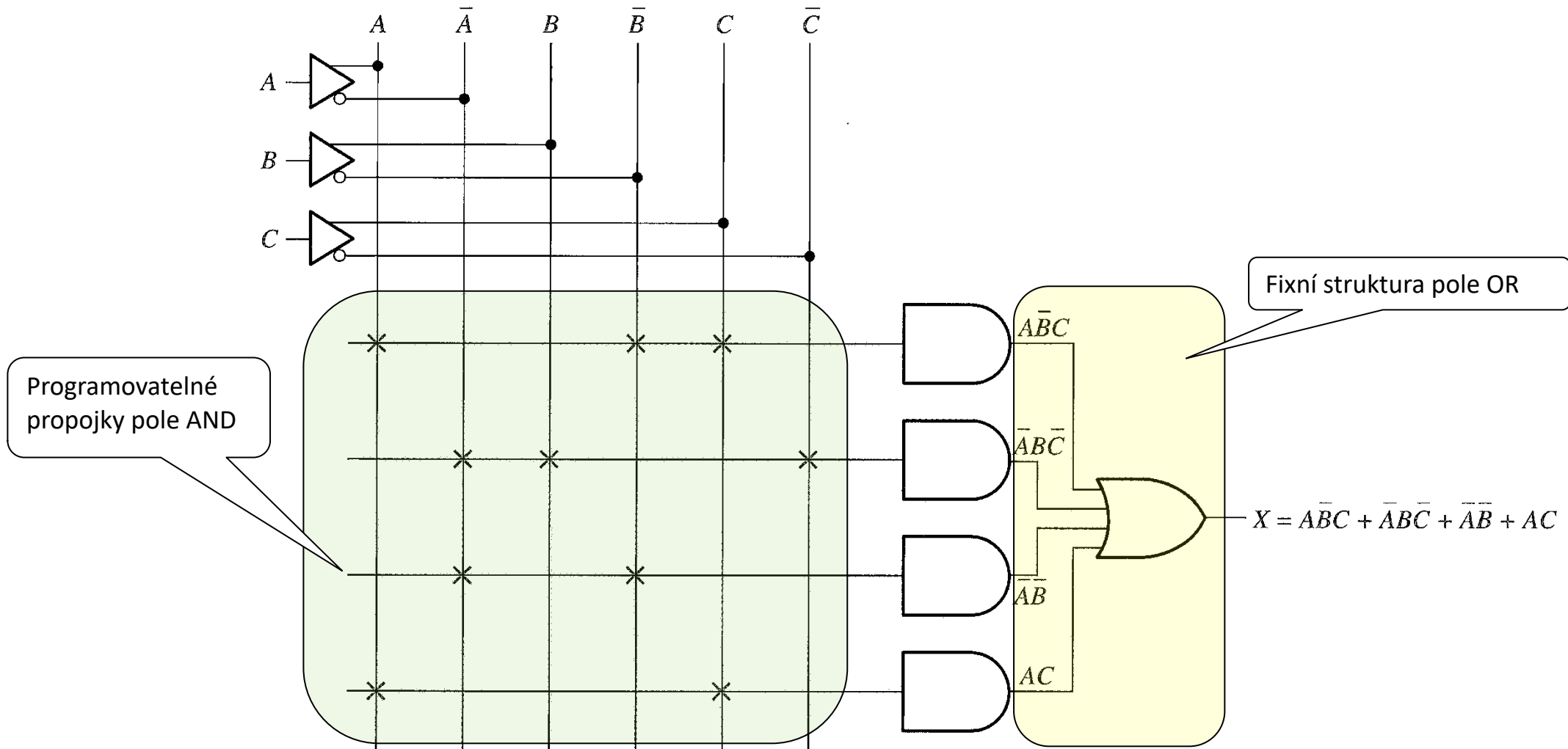


- Programmable Array Logic (PAL)

- Pouze pole AND je programovatelné
- Nemají omezení pamětí PROM (díky programovatelnému poli AND)
- Realizuje disjunktní formu
- *Jsou rychlejší díky fixnímu poli OR bez propojek*
- *Jsou levnější než PLA*



- Příklad implementace funkce tří proměnných pomocí PAL



- ***PAL (Programmable Array Logic)***

- Programovatelné AND pole (volba mintermu normální disjunktí formy se provádí pomocí destrukce propojek)
- Pevné OR pole (logický součet vybraných mintermů), které jsou často doplněny o klopné obvody

- ***GAL (Generic Array Logic)***

- Obdobná architektura jako PAL
- Propojky jsou však elektricky programovatelné (řízené pomocí paměťových buněk např. typu EEPROM)

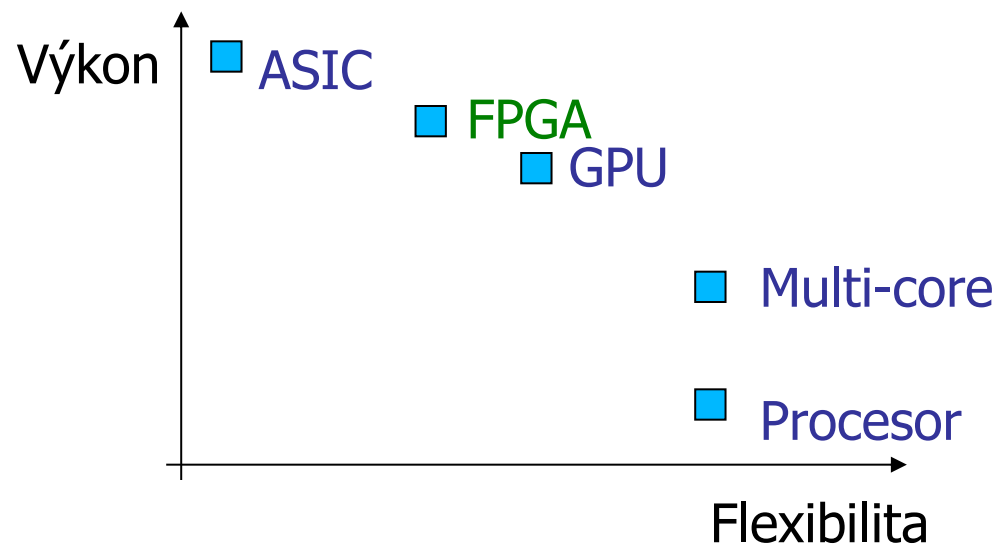
- ***CPLD (Complex Programmable Logic Devices)***

- Skládají se z AND-OR polí a registrů s elektricky (typicky pomocí paměťových buněk typu FLASH) programovatelnými křížovými přepínači

- Technologie CMOS
- Příkon v technologii CMOS
- Programovatelné struktury (PLD)
- *Technologie FPGA*

- Běžné procesory nepokrývají výkonnostní požadavky řady aplikací
 - Počítačové sítě, počítačová grafika, vědecké výpočty a další
- Technologie FPGA a ASIC mohou být vhodnou alternativou

Kompromis mezi flexibilitou a výkonem

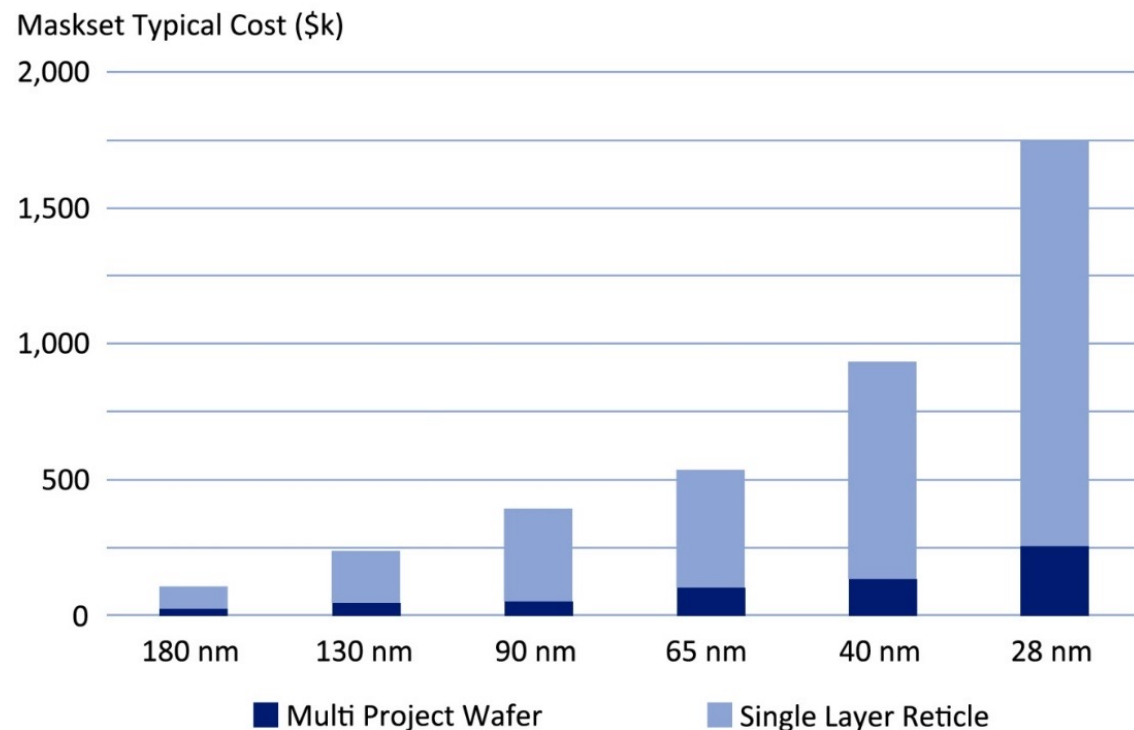


Flexibilita – v kolika aplikacích je vhodné danou technologii použít

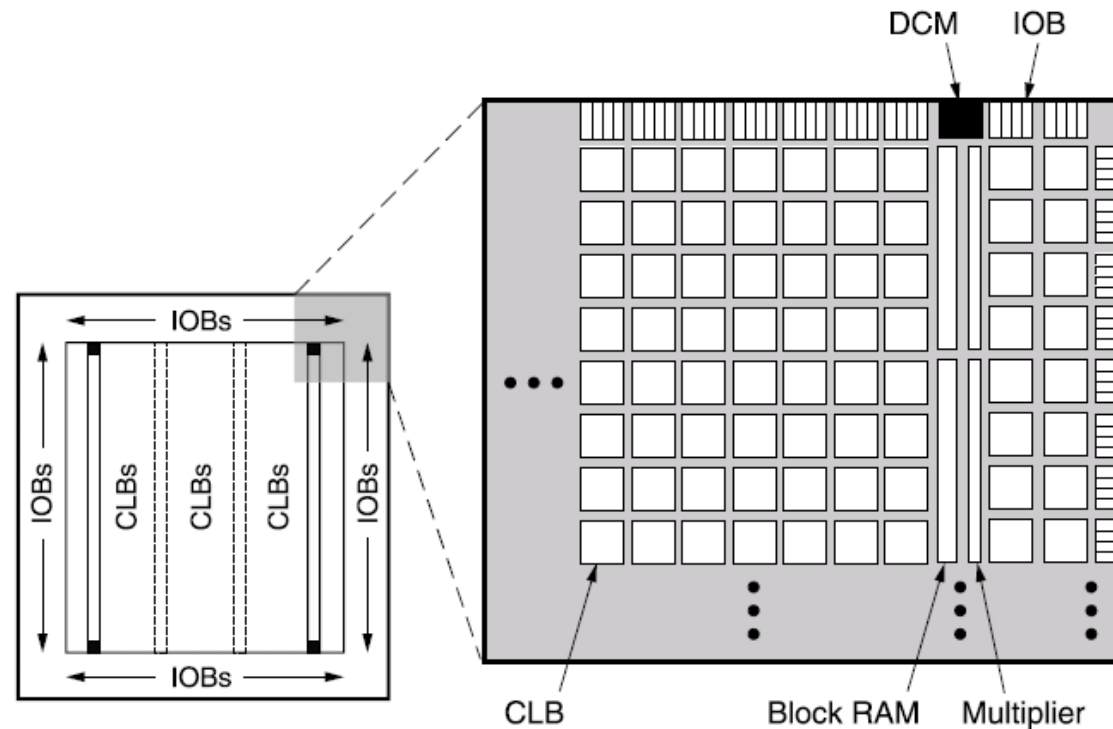
Výkon – porovnání rychlosti aplikací na různých technologiích

Nové technologie zvyšují rychlost FPGA čipů. Snižuje se počet aplikací, které je nutné řešit pomocí ASIC

- Cena návrhu masky u ASIC obvodů se pro nové technologie neustále zvyšuje
 - $\text{Cena} = \text{maska} + \text{návrh} + \text{verifikace} + \text{risk}$
- ASIC obvody jsou využívány zejména v extrémních aplikacích vyžadujících rychlost, malé rozměry, nízká spotřebu a vyráběných ve velkých sériích
- Výhody FPGA oproti ASIC:
 - Jednodušší návrh aplikace
 - Rychlejší vývoj, tj. rychlejší uvedení na trh
 - Možnost rekonfigurace
 - Oprava chyb
 - Nové vlastnosti aplikace



- 2D Matice konfigurovatelných logických bloků (CLB)
- Obvody pro řízení hodinového signálu (DCM, PLL, apod.)
- Vestavěné komponenty: blokové paměti a násobičky, DSP bloky, GTX, PCIe, PowerPC, apod.

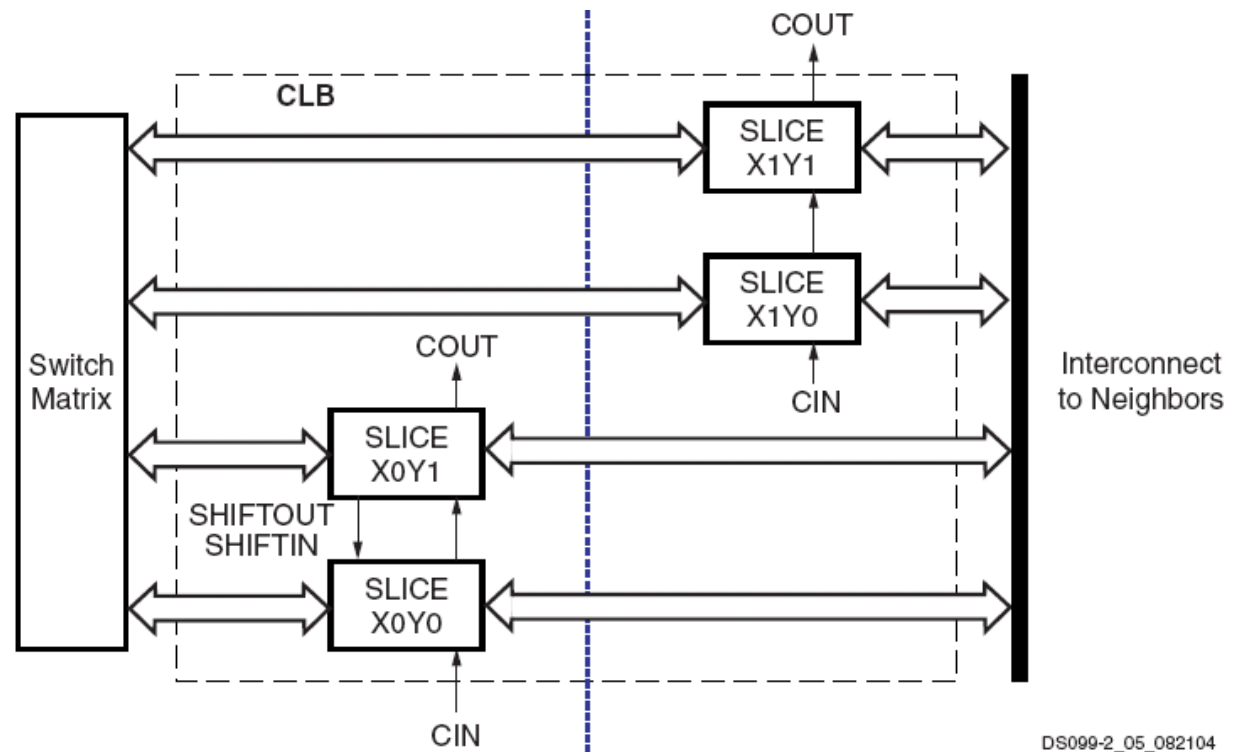


Obsahuje

- Několik SLICE bloků (menší logické elementy)
- Nezávislé „carry řetězce“ pro konstrukci rychlých sčítaček, násobiček, apod.
- Rychlé připojení k sousedním členům a připojení ke globální propojovací matici

Technologie

- Spartan3
 - 4 Slices / CLB
- Virtex UltraScale
 - 1 Slice / CLB



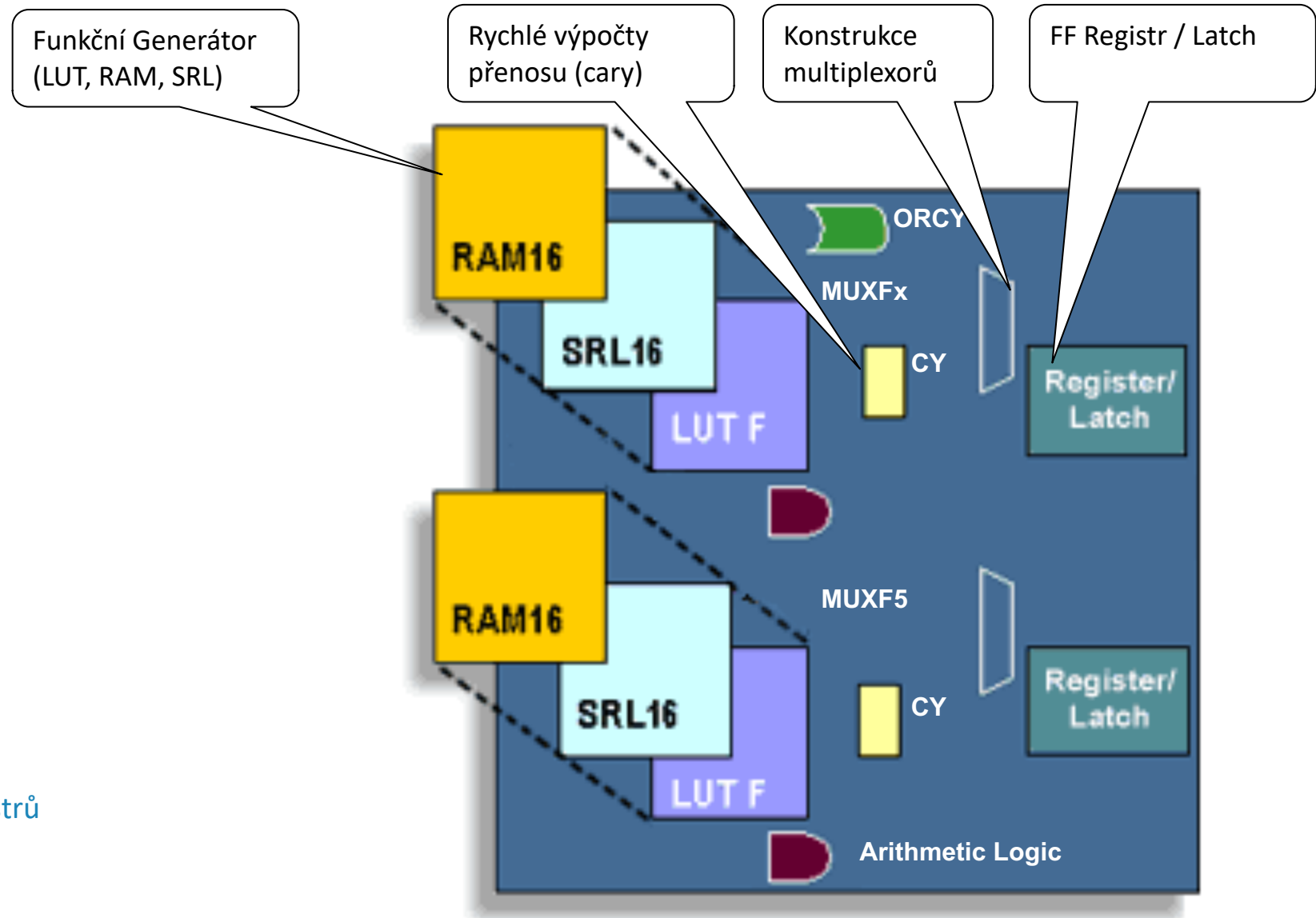
DS099-2_05_082104

Obsahuje

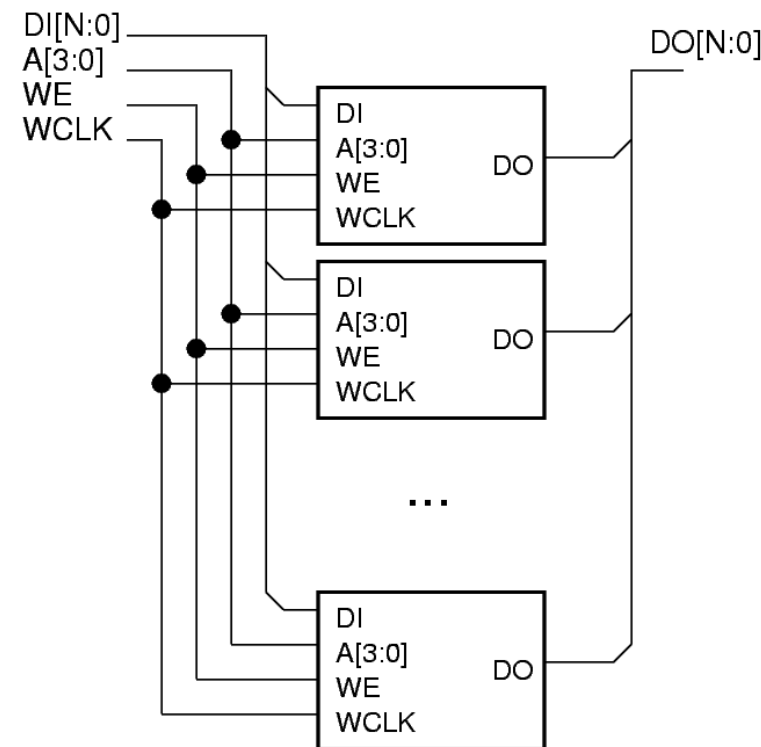
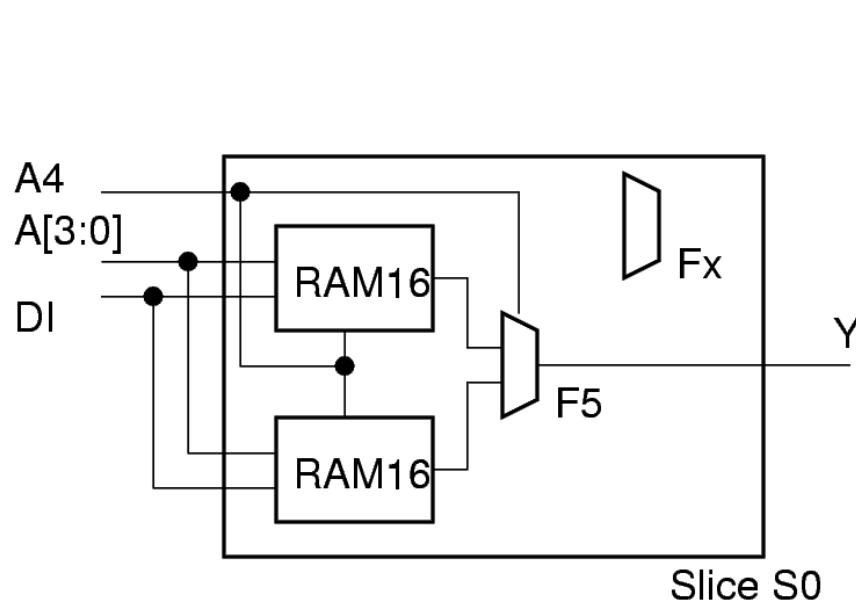
- Funkční generátory (FG)
 - LUT
 - RAM
 - SRL
- Registry/Latche
- Multiplexory MUXF_x
- “Carry” logiku
- Pomocná logika pro aritmetiku

Technologie

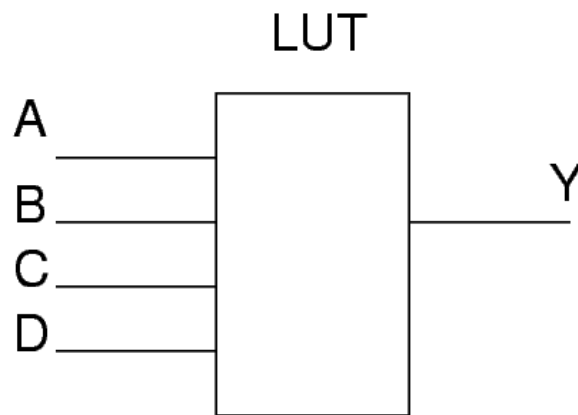
- Spartan3
 - 2x FG, 2x FDD
 - 768 - 33,280 SLICES
 - 1536 - 66,560 FGs a registrů
- Virtex UltraScale
 - 8x FG, 16x FDD
 - 44k – 316k SLICES
 - 358k – 2,5M FGs, dvojnásobek registrů



- Umožňuje vytvářet větší paměťové bloky
 - Pomocí MUXFx lze jednoduše tvořit paměti 32x1 bit, 64x1 bit, atd.
 - Paměti lze paralelně řadit vedle sebe a tvořit paměti o libovolné šířce dat



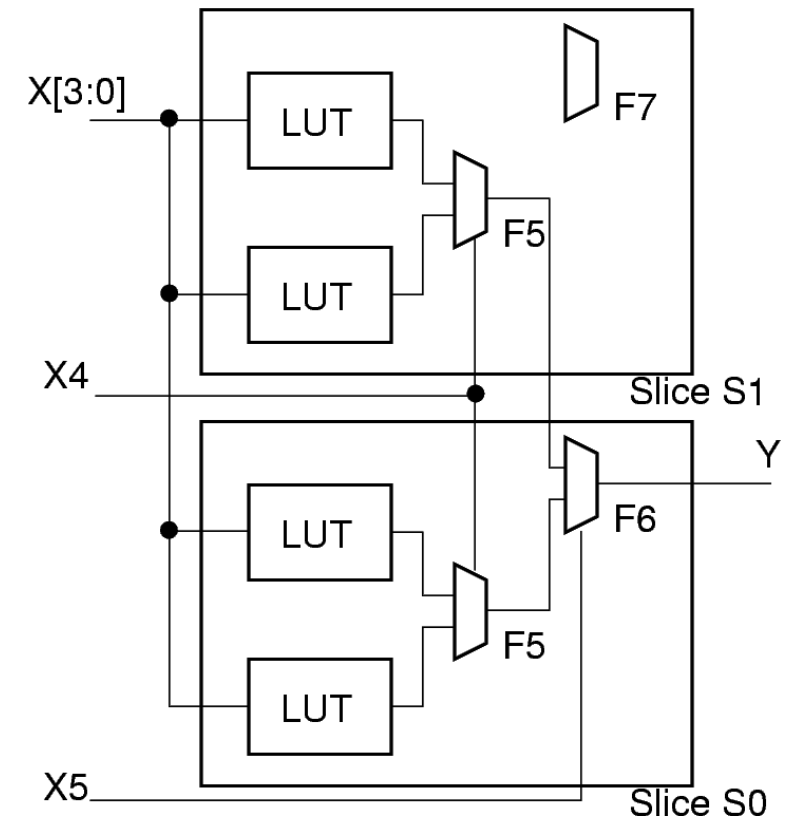
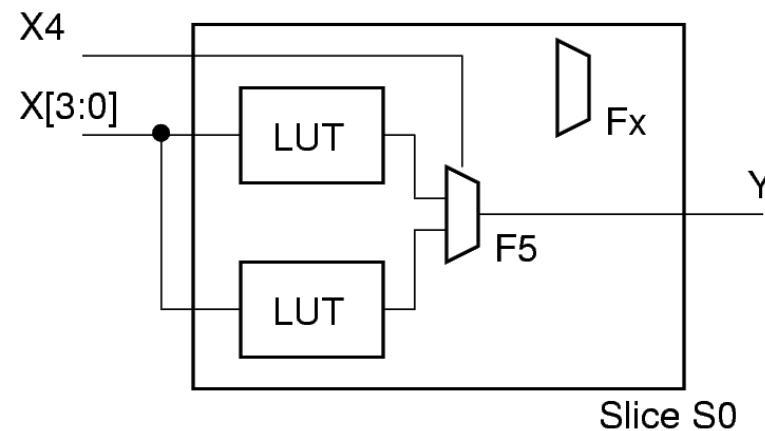
- Základní logické hradlo: N -bitový vstup, 1-bitový výstup
- Realizuje libovolnou binární funkci N proměnných
- Technologie
 - Spartan3: $N=4$
 - Virtex UltraScale+ : $N=6$
- Příklad
 - 4-vstupé hradlo



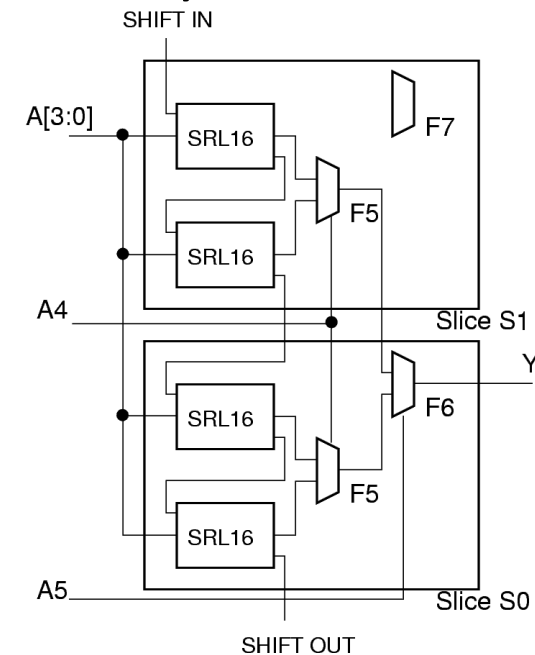
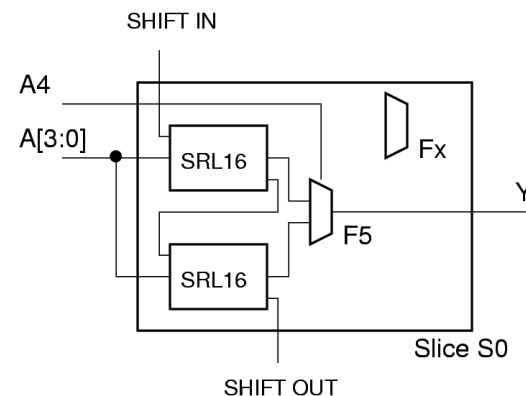
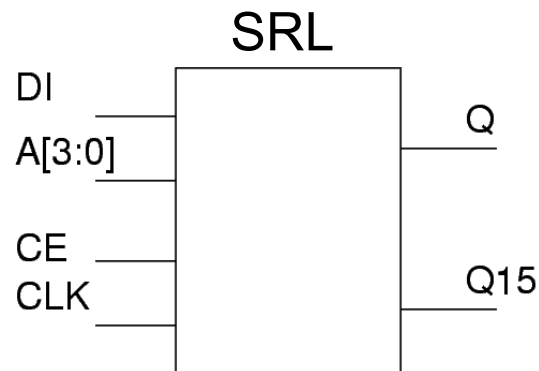
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$F(A,B,C,D) = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} \text{ or } A\bar{B}\bar{C}\bar{D} \text{ or } \bar{A}\bar{B}C\bar{D} \text{ or } ABCD$$

- Pomocí multiplexorů **MUXF_x** lze jednoduše vytvářet složitější funkce
- **MUXF_x** je potom označován jako MUXF5, MUXF6, ...
- **Příklad:**
 - 4-vstupé hradla LUT



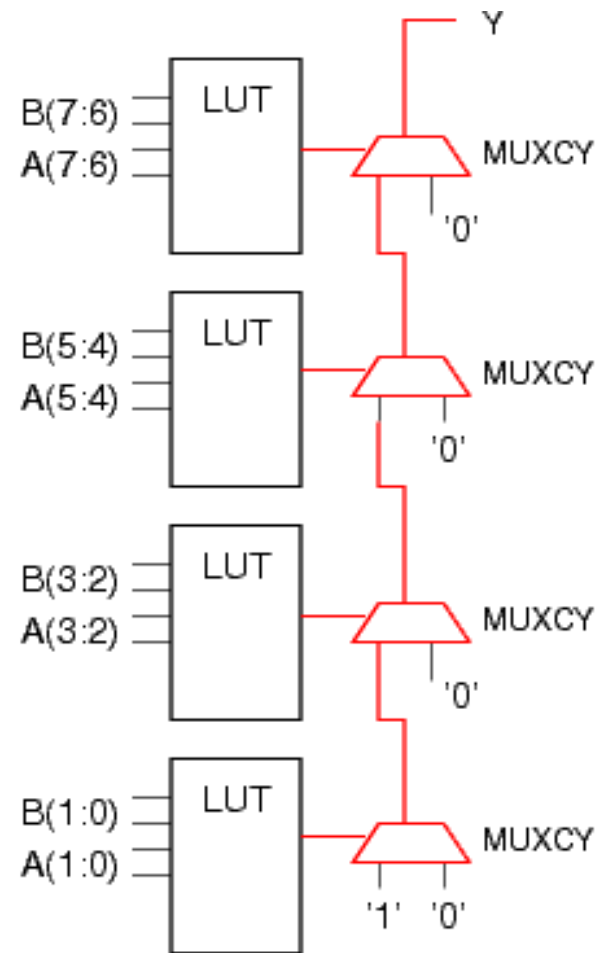
- Synchronní zápis, data v registru se posunou o jednu pozici
- Asynchronní čtení ze zadané pozice, výstup se objeví na Q
- Jednoduché rozšíření pomocí multiplexorů **MUXFx**
- Vhodný například pro konstrukci zpožďovacích obvodů, generátorů náhodných čísel (LFSR), čítače libovolných sekvencí, apod.
- Velká úspora zdrojů oproti implementaci pomocí registrů umístěných ve SLICE



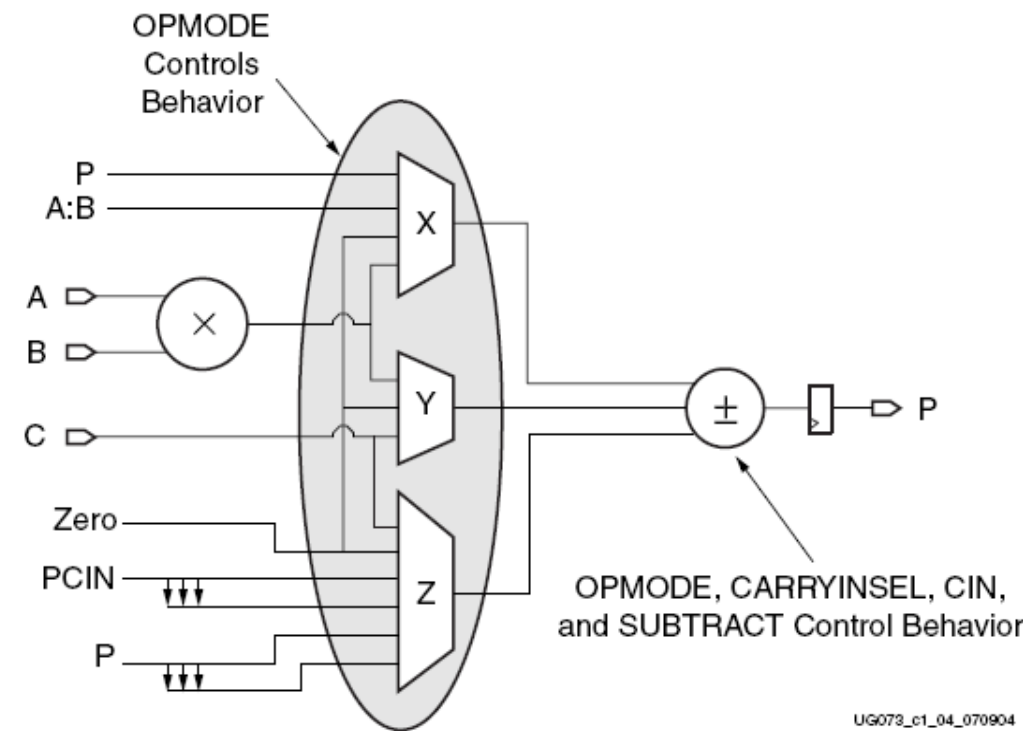
- Používá se pro konstrukci rychlých sčítaček, čítačů, komparátorů apod.
- Carry logika je v každém SLICE tvořena z
 - 2x multiplexor - **MUXCY**
 - 2x hradlo xor - **XORCY**
 - 1x hradlo or – **ORY**
- Příklad komparátoru ve VHDL:

```
Y <= '1' when (A = B)
      else '0';
```

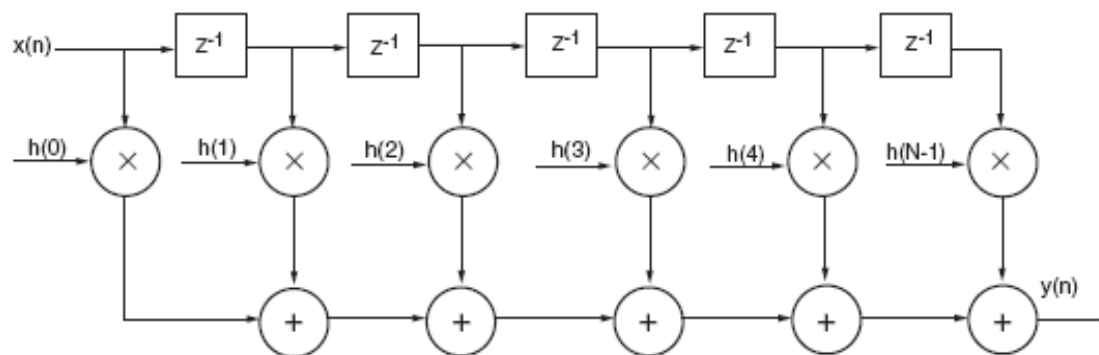
- LUTy porovnávají části operandů
- MUXCY vytváří logický AND



- V některých technologiích zcela nahrazuje vestavěné násobičky
- Zpravidla obsahuje:
 - násobičku NxM bitů
 - Sčítačku / odčítačku K bitů
 - Multiplexor
 - interní sběrnici
- Vhodné pro tvorbu DSP aplikací:
 - MAC FIR filtrů
 - paralelních FIR filtrů
 - vícekanálových filtrů
 - filtrů s proměnnou rychlostí
- Technologie Virtex UltraScale:
 - N=27, M=18, K=48
 - 600-2880 DSP bloků

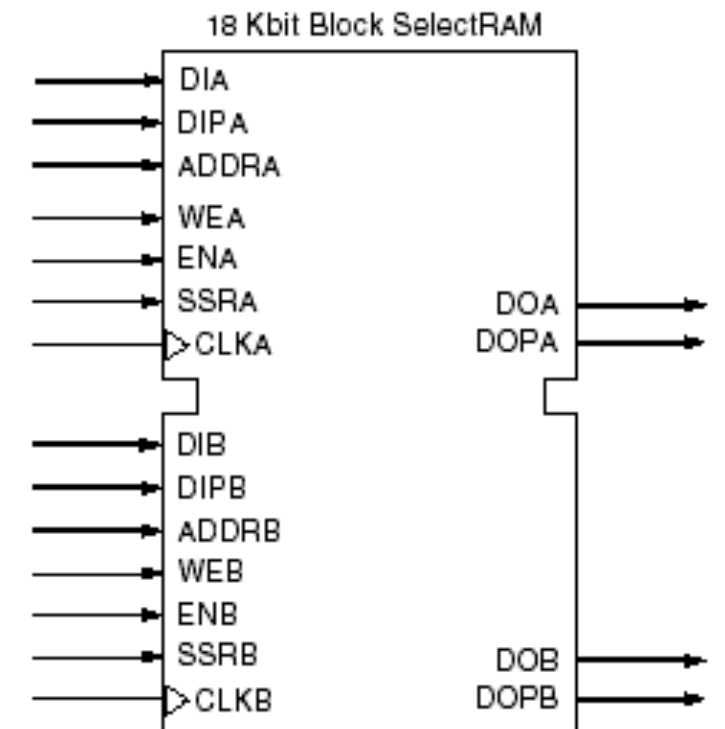
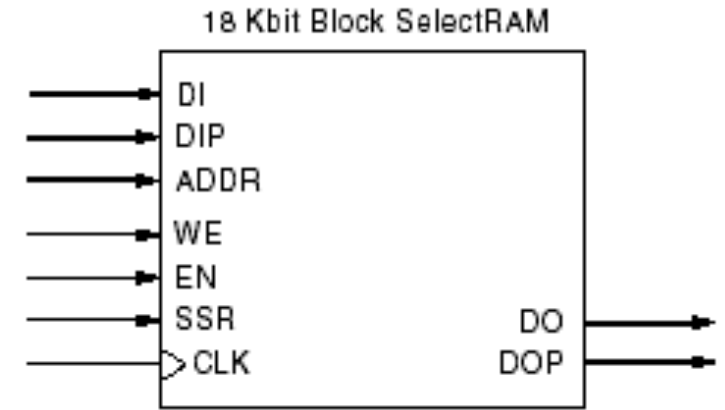


UG073_c1_04_070904

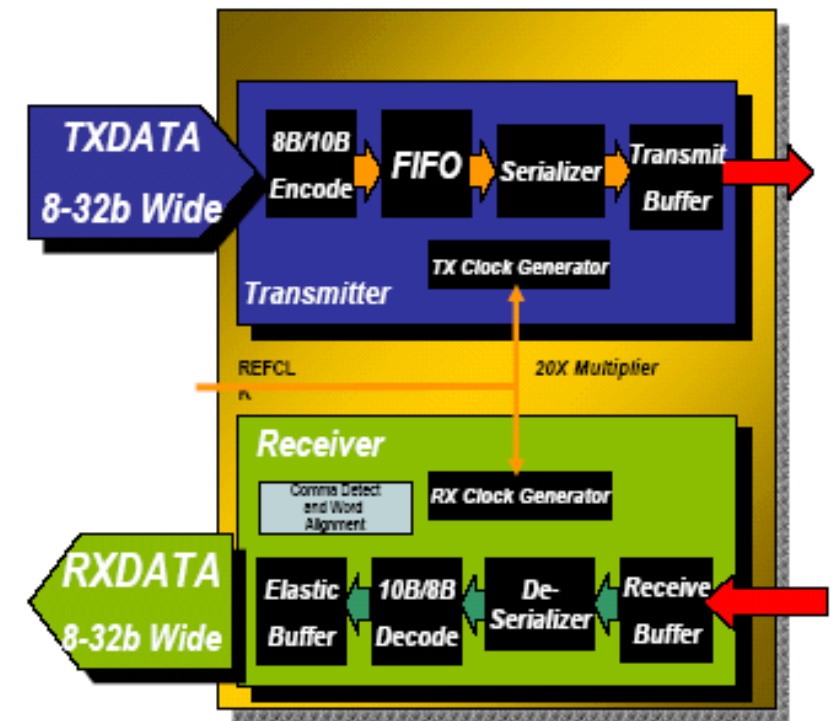
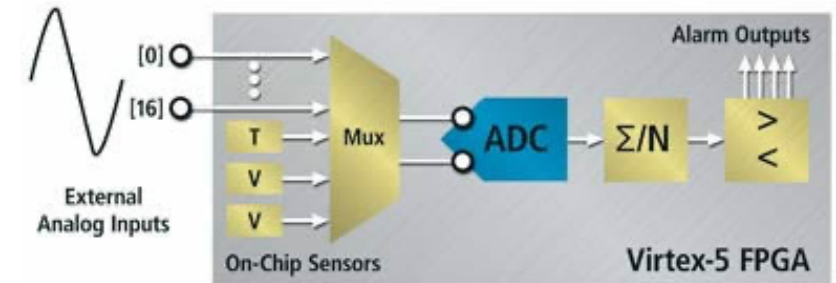
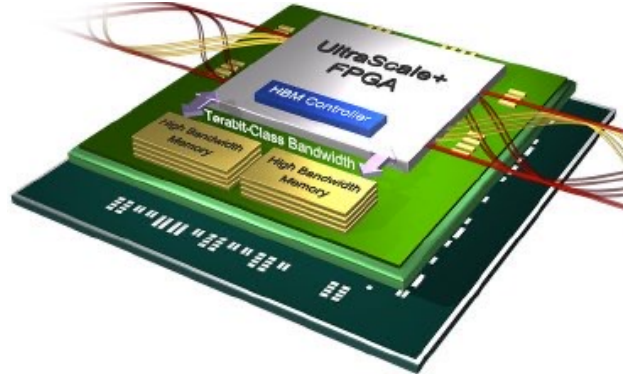
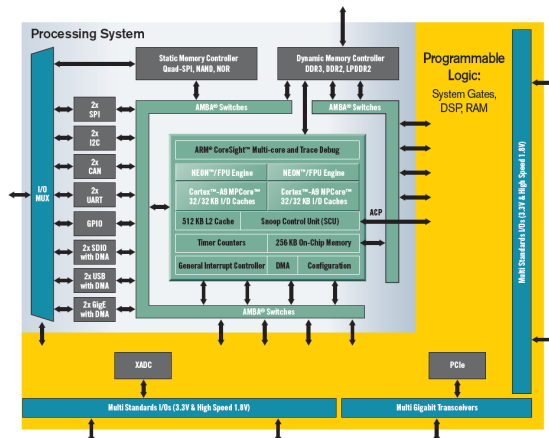


- **Vestavěný paměťový blok o velikosti jednotek kB**
- Obvykle synchronní čtení i zápis (data jsou dostupná v následujícím hodinovém taktu)
- **Jedno-portová i dvou-portová varianta**, pro každý port lze dostupný paměťový prostor rozdělit do různých datových šířek
- **Příklady různých pamětí velikosti 2kB**

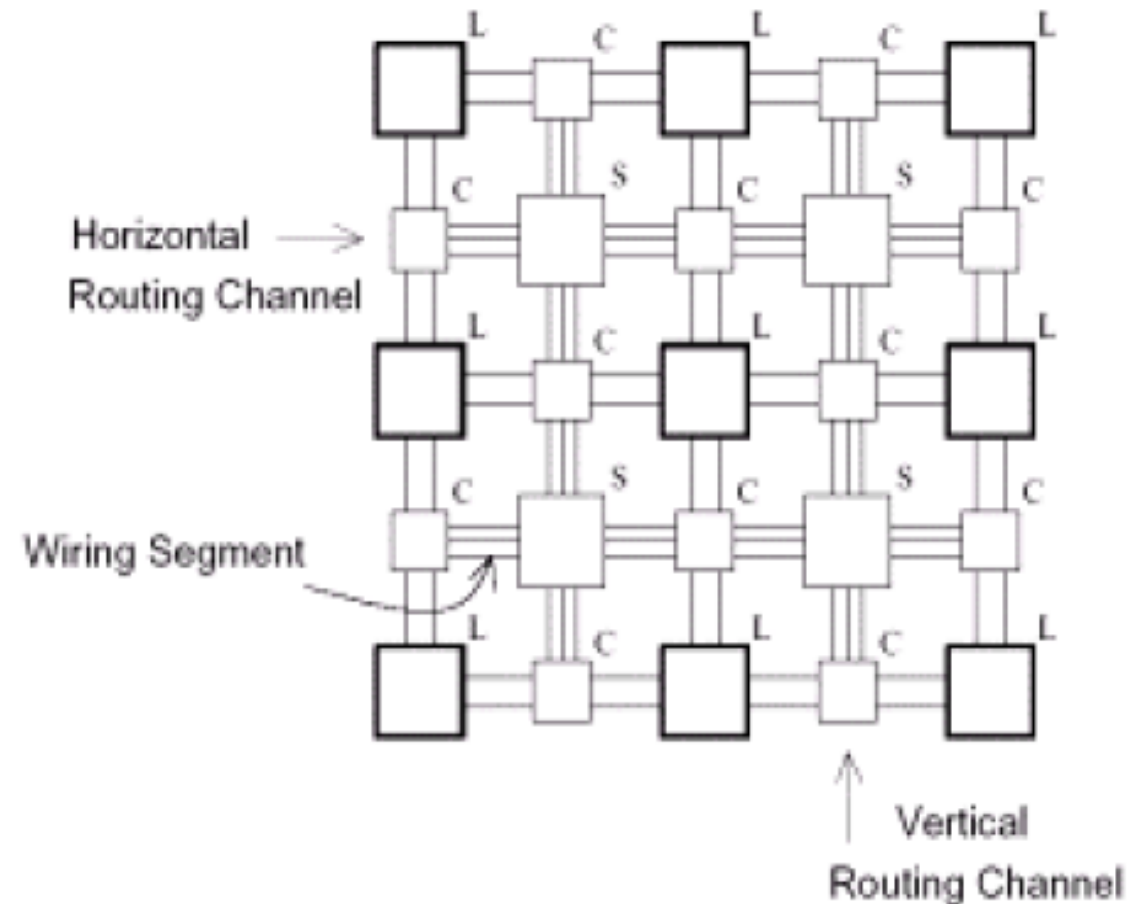
16k x 1 bit	2k x 8 bits
8k x 2 bits	1k x 16 bits
4k x 4 bits	512 x 32 bits



- Vysokorychlostní transceivery s podporou rozhraní
 - PCI Express Endpoint (až do PCI gen.6)
 - Rozhraní Ethernet (od 1 Gb až do 400 Gb)
- Podpora velkokapacitních pamětí
 - DDR DRAM řadiče integrované na čipu
 - HBM (460 GB/s) paměť integrovaná přímo na čipu
- Procesor ARM 1 až 4 jádra A9, A53 nebo A72
- Systém monitoring – čidla pro teplotu a napájení

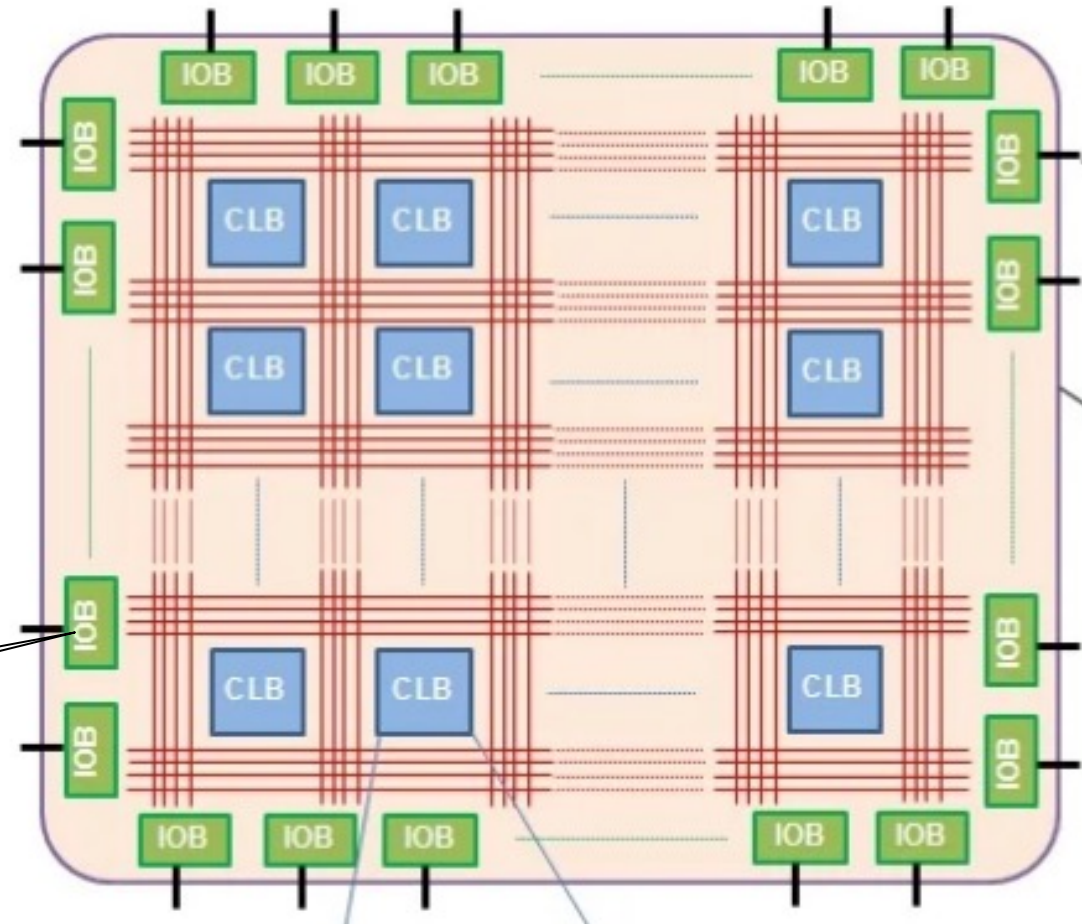


- Propojovací síť je tvořena **horizontálními a vertikálními vodiči**
- CLB bloky jsou na tuto síť připojeny skrze **C-boxy** (Connection)
- V místě průsečíku horizontálních a vertikálních vodičů je umístěn **S-Box** (Switch)
- *"Island Style"* architektura
- Až 80% plochy FPGA tvoří propoje



- Každý pin FPGA může být konfigurován jako vstup, výstup nebo obojí
- Jsou podporovány jednotlivé vodiče i diferenciální páry (pouze u dvou sousedních pinů)
- Je podporováno velké množství standardů:
 - LVTTTL, LVCMOS, PCI33, PCI66, PCI-X, GTL, HSTL, STTL, AGP
 - LVDS, LDT, LVPECL
- Podpora DDR1,2,3,4,5, QDR
- Digitálně řízená impedance (DCI) redukuje nutnost velkého množství ukončovacích rezistorů na desce

Propojení s ostatními
komponenty na desce PCB



- Konfigurace FPGA zahrnuje nastavení:
 - jednotlivých FG, registrů, carry řetězců, ...
 - BRAM pamětí včetně jejich počátečního obsahu
 - I/O bloků (použitá technologie, režim, připojení)
 - veškerých dalších vestavěných bloků
 - propojovacích prvků C-boxů, S-boxů
- Konfigurace je obvykle na FPGA čipu uložena v paměti typu SRAM ⇒ po vypnutí napájení se konfigurace ztrácí
- Některé typy konfigurovatelných obvodů (CPLD) používají paměť typu FLASH ⇒ omezený počet programování

- Režim Master

- FPGA čip si sám po zapnutí nahraje konfiguraci z externí paměti

- Skrze **sériové** rozhraní

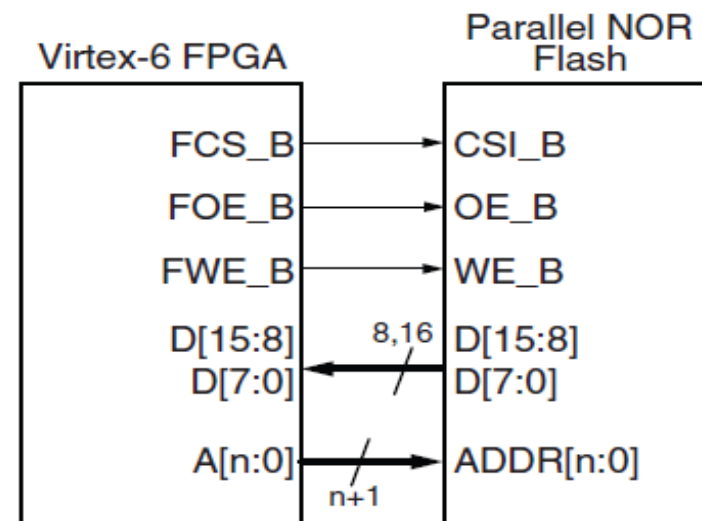
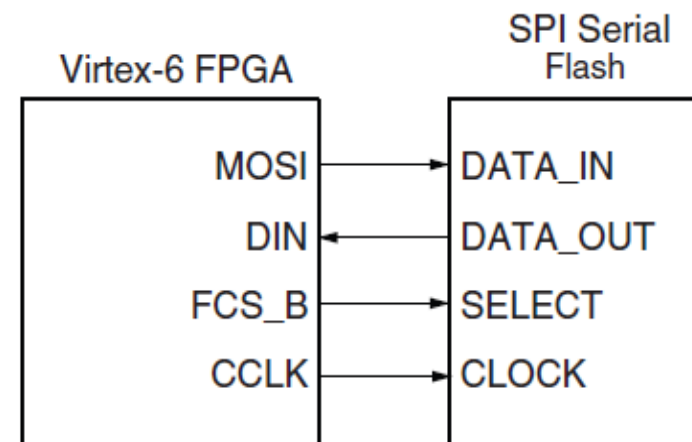
- SPI

- Nevýhodou může být delší doba pro načtení konfigurace

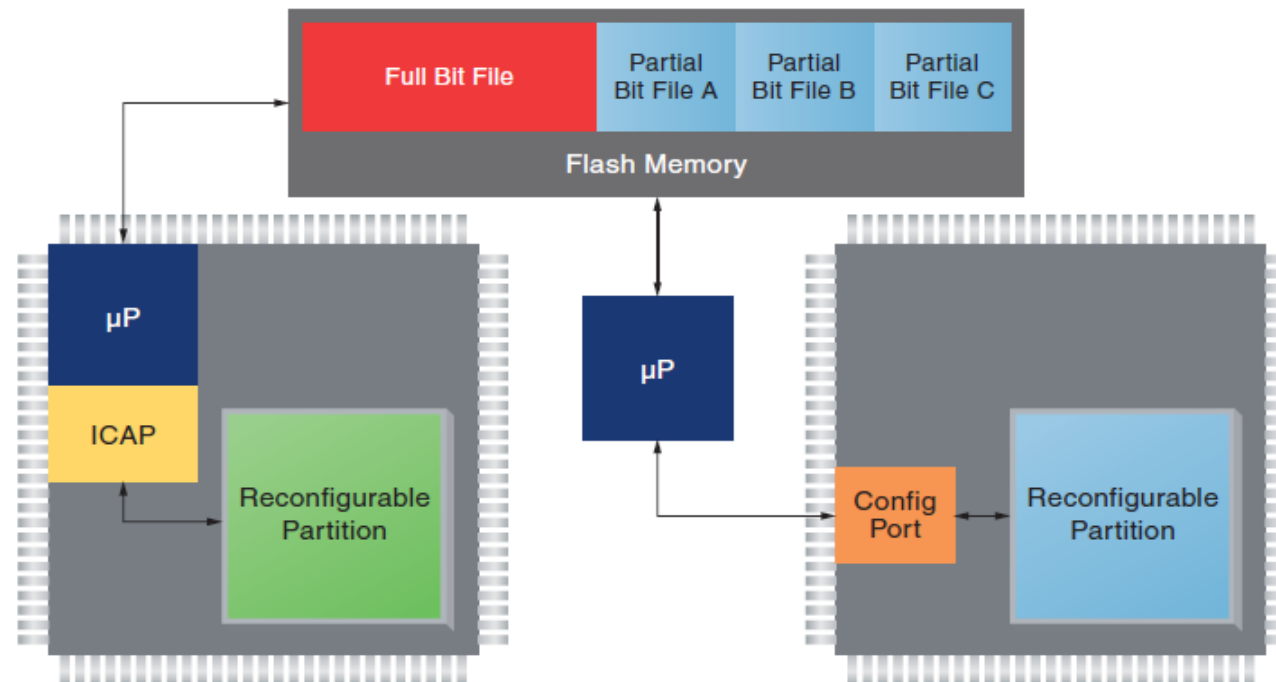
- Skrze **paralelní** rozhraní

- BPI, SelectMAP

- Použité vodiče obvykle nemohou být použity pro jiné účely a zvyšují cenu plošného spoje



- Možnost **rekonfigurovat** za běhu pouze část FPGA čipu
- Řídit lze z venku nebo zevnitř FPGA – přístup pomocí **ICAP** (Internal Configuration Access Port) komponenty.
- **Rekonfigurace** nabízí nové možnosti – rozsáhlé aplikace lze rozdělit na několik částí a vykonávat je postupně, úspora zdrojů, energie.



Thank You For Your Attention !